



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月18日

出願番号

Application Number:

特願2001-010622

出願人

Applicant(s):

日本碍子株式会社

2001年12月21日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造

出証番号 出証特2001-3110810

【書類名】 特許願

【整理番号】 PA00-187

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 41/08

【発明者】

【住所又は居所】 名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 池田 幸司

【発明者】

【住所又は居所】 名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 柴田 和義

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088971

【弁理士】

【氏名又は名称】 大庭 咲夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100115185

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 慎治

【選任した代理人】

【識別番号】 100076842

【弁理士】

【氏名又は名称】 高木 幹夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 075994

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧電／電歪デバイス

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスであり、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用し、前記基体を平面状に展開した形状に前記平板を打抜き加工し、打抜き加工されて形成された打抜構造体の所定形状の部位を屈曲して前記基体を形成していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に前後両端側に延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有していて、前記各側方溝部にて同溝部に沿って屈曲加工されて、同各側方溝部の側縁部位が前記各可動部に形成されているとともに、前記中央溝部の前後の各端部側の一方の部位が前記固定部に形成され、かつ、前記各端部側の他方の部位が被制御部材の取付部に構成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に前後両端側に延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両溝部間の前後各端部側の一方を切欠いた開口部位からなる門形状の開口部を有していて、前記各側方溝部にて同溝部に沿って屈曲加工されて、同各側方溝部の側縁部位が前記各可動部に形成されているとともに、前記各側方溝部間の部位が前記固定部に形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 4】 請求項 1 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記打抜構造体は、方形の平板の中央部に方形の開口部を有していて、前記開口部の左右の各側縁部にて同側縁部に沿って屈曲加工されて、前記開口部の側縁部位が前記各可動部に形成されているとともに、前記開口部の前後の各端部側の一方の部位が前記固定部に形成され、かつ、前記開口部の前後の各端部側の他方の部位が被制御部材

の取付部に形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 5】請求項 2，3 または 4 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各側縁部位を形成する前記打抜構造体の屈曲部は円弧状を呈していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 6】請求項 2，3，4 または 5 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部の前後方向の少なくとも中間部は厚みが薄く形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 7】請求項 2，3，4，5 または 6 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部における前記固定部側の端部に、同端部の上縁から前記固定部の表面側に屈曲して延びて当接する補強部を具備していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 8】請求項 2，3，4，5 または 6 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部における前記固定部側の端部に、同端部の端縁から内側に屈曲して延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 9】請求項 2，3，4，5 または 6 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部における前記固定部側の端部間に補強部材が介装されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 10】請求項 2，3，4，5，6，7，8 または 9 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部間に形成されている固定部は、前記各可動部の端部から先端側へ突出していて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 11】請求項 2，4，5，6，7，8，9 または 10 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部間に形成されている取付部は、前記各可動部の端部から先端側へ突出していて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 12】請求項 2，4，5，6，7，8，9，10 または 11 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記各可動部および固定部を構成する平板は金属製であることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項 1 3】請求項 2, 3 または 4 に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記打抜構造体の開口部は、前記平板の打抜き加工と同時に打抜きされて形成され、または、前記平板の打抜き加工後の穴開け加工にて形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電／電歪デバイスに関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

圧電／電歪デバイスの一形式として、ヨーロッパ特許出願（E P 1 0 1 7 1 1 6 A 2）明細書に開示されているように、左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設してなる圧電／電歪素子を具備する形式の圧電／電歪デバイスがある。

【 0 0 0 3 】

当該形式の圧電／電歪デバイスは、圧電／電歪素子の変位動作に起因する可動部の作動機能、または、被検出側から入力される可動部の変位を圧電／電歪素子により検出する検出機能を有するもので、これらの機能を有効に利用して、下記のごとき広い用途に使用されている。

【 0 0 0 4 】

すなわち、当該形式の圧電／電歪デバイスは、各種トランスデューサ、各種アクチュエータ、周波数領域機能品（フィルタ）、トランス、通信用、動力用の振動子や共振子、発振子、ディスクリミネータ等の能動素子、超音波センサ、加速度センサ、角速度センサ、衝撃センサ、質量センサ等の各種センサ素子、光学機器、精密機器等の各種精密部品等の変位や位置決め調整、角度調整の機構に用いられる各種アクチュエータ等を使用される。

【 0 0 0 5 】

ところで、当該形式の圧電／電歪デバイスは、一般には、デバイス原盤を適宜

の大きさに切断して形成されるもので、デバイス原盤は、基体原盤の表裏両面に圧電／電歪素子を接着剤を介して接着して構成され、または、これらを一体に形成して構成されている。なお、基体原盤は、複数枚のシートを積層し焼成して構成されている。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

このように、当該形式の圧電／電歪デバイスは、その構成部品の部品点数が多くて、コストが高いたとも組立作業が面倒であり、かつ、各構成部品同士を接着剤を介して接着していることから、各構成部品同士の接着にバラツキが生じて、デバイス特性に影響を及ぼすおそれがある。

【 0 0 0 7 】

また、当該形式の圧電／電歪デバイスを形成するには、デバイス原盤を適宜に切断して多数取りする手段が採られることから、切断して形成された圧電／電歪デバイスは、切断時に発生する塵埃や切削液、さらには、切断時にデバイス原盤を保持するために使われる接着剤やワックス等の有機成分により汚染されていて、圧電／電歪デバイスの洗浄が容易ではない。

【 0 0 0 8 】

また、基体をセラミックスで構成する場合は、セラミックスが割れ易いため、ジルコニア等の硬い材質のセラミックスを選択する必要がある、硬い材料のセラミックスを選択した場合でも、欠損やクラックが発生しないように適切な切断条件を選定する必要がある。また、基体が硬い材料のセラミックスであることから加工し難く、加工処理数を増やすためには、異なる機能の多くの加工装置を使用する等の配慮をする必要がある。

【 0 0 0 9 】

基体を金属材料で構成することも可能であるが、金属材料は切削加工中に摩擦熱で端面が酸化したり、加工端面にバリが残留するため、これらを除去する別工程を追加しなければならない。また、圧電／電歪素子の検査は、デバイス原盤を切断した後でなければならない。

【 0 0 1 0 】

また、デバイス原盤から切り出したデバイスの洗浄には、汚れが容易に除去し得る超音波洗浄を採用することが好ましいが、超音波洗浄において洗浄効果を挙げるべく強い超音波を使用すると、デバイスにダメージを与えることがあり、圧電／電歪素子が基体から剥離したり破損することもある。このため、超音波洗浄を採用する場合には、デバイスにダメージを与えない弱い超音波を選定する必要があるが、このような洗浄条件により切断時に付着する汚れを除去するには長時間を要することになる。

【 0 0 1 1 】

圧電／電歪デバイスからの発塵は、例えば、ハードディスクドライブの磁気ヘッドのアクチュエータに圧電／電歪デバイスを使用する場合にドライブの中で発塵すると、その塵が浮上スライダーとメディアのクラッシュの原因となり、データを破壊するおそれがある。また、圧電／電歪デバイス自身に対しても、その塵が圧電／電歪素子の電極に付着してショートを引起すおそれがある。このため、ハードディスクドライブに対しては勿論のこと、デバイス自身にも高い清浄度が要求される。

【 0 0 1 2 】

従って、本発明の目的は、当該形式の圧電／電歪デバイスを構成する基体を、平板を原板とする一体構造とすることにより、上記した各問題を解消することにある。

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

本発明は圧電／電歪デバイスに関し、特に、左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する形式の圧電／電歪デバイスを適用対象とするものである。

【 0 0 1 4 】

しかして、本発明に係る圧電／電歪デバイスは、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用し、前記基体を平面状に展開した形状に前記平板を打抜き加工して、打抜き加工にて形成された打抜構造体の所定形状の部位

を屈曲することにより、前記基体を形成していることを特徴とするものである。

【 0 0 1 5 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に前後両端部側に延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有していて、前記各側方溝部にて同溝部に沿って屈曲加工することにより、同各側方溝部の側縁部位を前記各可動部に形成するとともに、前記中央溝部の前後の各端部側の一方の部位を前記固定部に形成し、かつ、前記各端部側の他方の部位を被制御部材の取付部に形成するようにすることができる。

【 0 0 1 6 】

また、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に前後両端側に延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両溝部間の前後各端部側の一方を切欠いた開口部位からなる門形状の開口部を有していて、前記各側方溝部にて同溝部に沿って屈曲加工することにより、同各側方溝部の側縁部位を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部に形成するようにすることができる。

【 0 0 1 7 】

また、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、前記打抜構造体は、方形の平板の中央部に方形の開口部を有していて、前記開口部の左右の各側縁部にて同側縁部に沿って屈曲加工することにより、前記開口部の側縁部位を前記各可動部に形成するとともに、前記開口部の前後の各端側の一方の部位を前記固定部に形成し、かつ、前記開口部の前後の各端側の他方の部位を被制御部材の取付部に形成するようにすることができる。

【 0 0 1 8 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、上記した 3 種類の構造の圧電／電歪デバイスを基本構成として、これらの各圧電／電歪デバイスを、さらに下記のごとく構成することができる。なお、これらの各圧電／電歪デバイスの基体を形成する打抜構造体が有する各開口部は、前記平板の打抜き加工と同時に打抜きされて形成され、または、前記平板の打抜き加工後の穴開け加工にて形成されて

いる。

【 0 0 1 9 】

すなわち、これらの各圧電／電歪デバイスにおいては、前記各側縁部位を形成する前記打抜構造体の屈曲部を円弧状に形成すること、前記各可動部の前後方向の少なくとも中間部の厚みを薄く形成すること、前記各可動部における前記固定部側の端部に、同端部の上縁から前記固定部の表面側に屈曲して延びて当接する補強部を具備すること、前記各可動部における前記固定部側の端部に、同端部の端縁から内側に屈曲して延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備すること、前記各可動部における前記固定部側の端部間に補強部材を介装すること等の構成を採ることができる。

【 0 0 2 0 】

また、これらの各圧電／電歪デバイスにおいては、前記各可動部間に形成されている固定部を、前記各可動部の端部から先端側へ突出させて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大すること、前記各可動部間に形成されている取付部を、前記各可動部の端部から先端側へ突出させて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大すること等の構成を採ることができる。

【 0 0 2 1 】

なお、これらの全ての圧電／電歪デバイスにおいては、前記各可動部および固定部を構成する平板として、金属製の平板を採用することができる。

【 0 0 2 2 】

【発明の作用・効果】

本発明に係る圧電／電歪デバイスは、固定部と取付部が可撓性を有する2つの側縁部を介して緊密に連結されていることが、作動原理上必要とされるなかで一体成形されているので、作動原理上最も好ましい形態を具現化している。

【 0 0 2 3 】

例えば、上記した3つの要部を金属製として溶着した場合においては、溶着の熱による歪み、材質劣化、焼き鈍し等の熱処理工程の増加等を配慮しなければならない。一方、金属製であって本発明の基体のごとく一体成形によるものは、このような懸念は全くない上に、一体成形時の加工硬化による連結部の強度の向上

も期待することができる。

【 0 0 2 4 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、部品（例えばハードディスクドライブの磁気ヘッド）と組合わせた場合、部品の高さとデバイスの高さの和が組立後の高さにはならず、コンパクトな構成とし得る利点がある。デバイスの高さでは、可動部の板の厚み分と接着剤の厚み分が部品の高さに加わるが、冒頭で記述した公知のデバイスに比較して組立後の高さを低くできて、省スペース化の効果がある。また、部品を固定部上に接着するのみで簡単に組立ができ、かつ、接着面積を広くとることができるため、接着強度をより強固にし得て、衝撃によっても脱落し難い構造とすることができる利点がある。

【 0 0 2 5 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、その構造上、取付部および固定部の被接着部品に対する接着部位に、接着剤が入る窪みをプレスにて形成することが容易であり、これにより、接着強度を増加させたり接着剤のはみ出しを抑制することができる。また、部品組立の際に用いる位置決め用の基準位置（穴等）を形成することも容易であり、これにより、後工程で部品をデバイス上の取付部に組立てたり、固定部をサスペンションのジンバルに取付ける際の組立精度を上げて、歩留まりを一層向上させることができる。デバイスを組立てる前に圧電／電歪素子を予め検査して組立てることで、組立後のデバイスの特性不良を大幅に低減することができる。

【 0 0 2 6 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスは、上記した 3 種類の構造の圧電／電歪デバイスを基本とするもので、これらの基本構造の圧電／電歪デバイスにおいては、いずれの基体も、平板を原板とする一体構造のもので原則的に 1 個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体と圧電／電歪素子の 2 種類となり、圧電／電歪デバイスの構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【 0 0 2 7 】

また、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、構成部品の部品点数が極

めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性を有するものである。

【 0 0 2 8 】

また、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、その形成にあつては、デバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃やその他の汚染物による汚染がない。このため、圧電／電歪デバイスを組立てる際に、予め、基体および圧電／電歪素子を洗浄しておけば、形成された圧電／電歪デバイスでは汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイスの洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができる利点がある。

【 0 0 2 9 】

【発明の実施の形態】

本発明は、左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスである。図 1 は、本発明に係る圧電／電歪デバイスの多数の実施形態（第 1 の実施形態～第 9 の実施形態）を示している。

【 0 0 3 0 】

図 1 (a) に示す第 1 の実施形態である第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a は、図 2 に示す状態で使用されるもので、図 3 および図 4 に示す方法で形成される。第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a は、基体 1 1 と一対の圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b からなるもので、基体 1 1 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 1 1 a, 1 1 b と、両可動部 1 1 a, 1 1 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 1 1 c と、両可動部 1 1 a, 1 1 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 1 1 d にて構成されている。

【 0 0 3 1 】

基体 1 1 においては、各可動部 1 1 a, 1 1 b、固定部 1 1 c、および取付部 1 1 d が、H 形状の開口部 1 1 e にて分割されている。開口部 1 1 e は、左右一

対の側方溝部 1 1 e 1, 1 1 e 2 と、これら両側方溝部 1 1 e 1, 1 1 e 2 を長手方向の中央部で互いに連結する中央溝部 1 1 e 3 とからなり、左側の可動部 1 1 a は、側方溝部 1 1 e 1 にて同溝部 1 1 e 1 に沿って屈曲されて、固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に対して直交状態に起立している。同様に、右側の可動部 1 1 b は、側方溝部 1 1 e 2 にて同溝部 1 1 e 2 に沿って屈曲されて、固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に対して直交状態に起立している。

【 0 0 3 2 】

かかる構成の基体 1 1 には、各可動部 1 1 a, 1 1 b の外側面に、各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b がエポキシ樹脂等からなる接着剤を介して接着されている。各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b は、圧電／電歪層と電極膜からなる多層体であって、各可動部 1 1 a, 1 1 b とは同一形状で、所定長さ短く形成されていて、各可動部 1 1 a, 1 1 b の固定部 1 1 c 側の端部に一致して接着されて、各可動部 1 1 a, 1 1 b の取付部 1 1 d 側の端部から所定長さを残した部位まで延びている。

【 0 0 3 3 】

当該基体 1 1 においては、その固定部 1 1 c の下面側にて、ハードディスクのヘッドを保持するサスペンションのジンバルに接着されて固定され、かつ、取付部 1 1 d の上面には、例えば、被制御部品であるハードディスク用の磁気ヘッド H が接着されて固定されている。なお、この場合、磁気ヘッド H とサスペンションの取付位置を上記とは逆に、取付部 1 1 d および固定部 1 1 c に変更することができ、これによってもデバイスの機能は何等変わらない。また、磁気ヘッド H とサスペンションの取付位置の固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に対する取付部位を表裏逆に変更することもでき、これによってもデバイスの機能は何等変わらない。但し、圧電／電歪素子の端子部にコンタクトする外部電極の配線をサスペンション上で逆に配線する必要がある。

【 0 0 3 4 】

しかして、当該圧電／電歪デバイス 1 0 a を構成する基体 1 1 は、図 3 (a) に示す原板 1 1 A を成形材料とするもので、原板 1 1 A を同図 (b) に示すように屈曲して形成されているものである。原板 1 1 A は、可撓性で屈曲加工が可能

な平板を打抜き加工してなる打抜構造体であって、基体 1 1 を平面状に展開した形状に加工されている。原板 1 1 A を構成する平板は、強度的には金属製であることが好ましい。

【 0 0 3 5 】

平板は、ヤング率が 1 0 0 G P a 以上の金属製であることが好ましく、鉄系材料としては、SUS 3 0 1、SUS 3 0 4、A I S I 6 5 3、S U H 6 6 0 等のオーステナイト系ステンレス鋼、SUS 4 3 0、SUS 4 3 4 等のフェライト系ステンレス鋼、SUS 4 1 0、SUS 6 3 0 等のマルテンサイト系ステンレス鋼、SUS 6 3 1 2、A I S I 6 3 2 等のセミオーステナイト系ステンレス鋼、エルマージングステンレス鋼、各種ばね鋼鋼材等を挙げることができる。また、非鉄系材料としては、チタン-ニッケル合金等の超弾性チタン合金、黄銅、白銅、アルミニウム、タングステン、モリブデン、ベリリウム銅、リン青銅、ニッケル、ニッケル鉄合金、チタン等を挙げることができる。

【 0 0 3 6 】

原板 1 1 A は、平板を打抜き加工に付されて形成されているもので、H 形状の開口部 1 1 e を具備している。開口部 1 1 e は、原板 1 1 A の左右の各側部に前後両端側に延びる一対の直線状の側方溝部 1 1 e 1、1 1 e 2 と、これら両側方溝部 1 1 e 1、1 1 e 2 を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部 1 1 e 3 からなる。基体 1 1 は、原板 1 1 A の左右の各側部を、各側方溝部 1 1 e 1、1 1 e 2 にて、同溝部 1 1 e 1、1 1 e 2 の幅の中心をその長手方向に延びる中心線 L 1、L 2 に沿って直角に屈曲することにより形成されている。原板 1 1 A の左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各側方溝部 1 1 e 1、1 1 e 2 の側縁部位が各可動部 1 1 a、1 1 b に形成されるとともに、中央溝部 1 1 e 3 の前端部側の部位が固定部 1 1 c に形成され、かつ、後端部側の部位が取付部 1 1 d に形成される。

【 0 0 3 7 】

このように、原板 1 1 A で一体に構成された基体 1 1 には、図 4 (a) に示すように、その各可動部 1 1 a、1 1 b の外側面に圧電／電歪素子 1 2 a、1 2 b を接着剤を介して接着されて、同図 (b) に示す圧電／電歪デバイス 1 0 a が形

成される。形成された圧電／電歪デバイス 1 0 a は、従来のこの種形式の圧電／電歪デバイスと同様に機能するとともに、基体 1 1 が原板 1 1 A にて一体的に構成されていることから、下記のごとき作用効果を奏するものである。

【 0 0 3 8 】

すなわち、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a は、原板 1 1 A のみからなる一体構造のもので 1 個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体 1 1 と圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b の 2 種類となり、圧電／電歪デバイス 1 0 a の構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を大幅に低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【 0 0 3 9 】

また、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、構成部品の部品点数が極めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性を有するものとなる。

【 0 0 4 0 】

また、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、その形成にあつては、従来のごとくデバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃、その他の汚染物の付着に起因する汚染がない。このため、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a の組立てに際して、予め、基体 1 1 および圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b を洗浄しておけば、組立てられた圧電／電歪デバイス 1 0 a は汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイス 1 0 a の洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができるという大きな利点がある。

【 0 0 4 1 】

図 1 の (b), (c), (e) ~ (h) に示す第 2 の実施形態である第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b ~ 第 7 の実施形態である第 7 圧電／電歪デバイス 1 0 g は、同図 (a) に示す第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a を基本構成するものである。

【 0 0 4 2 】

図 1 (b) に示す第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b は、第 1 圧電／電歪デバイス

1 0 a とは基体の構成をわずかに異にするもので、第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b は図 6 (b) に示すように、基体 1 3 と一対の圧電／電歪素子 1 2 a , 1 2 b からなり、基体 1 3 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 1 3 a , 1 3 b と、両可動部 1 3 a , 1 3 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 1 3 c と、両可動部 1 3 a , 1 3 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 1 3 d にて構成されている。

【 0 0 4 3 】

基体 1 3 においては、各可動部 1 3 a , 1 3 b 、固定部 1 3 c 、および取付部 1 3 d が、H 形状の開口部 1 3 e にて分割されていて、かかる構成に関するかぎり、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a の基体 1 1 と同一構成である。しかし、基体 1 3 においては、各側縁部位である各可動部 1 3 a , 1 3 b を構成する屈曲部 1 3 a 1 , 1 3 b 1 が、固定部 1 3 c , 1 3 d の面より窪んだ円弧状を呈している。

当該基体 1 3 の原板 1 3 A は、図 5 (a) に示すように、基体 1 1 の原板 1 1 A と同一のもので、各可動部 1 3 a , 1 3 b を屈曲形成する際の屈曲形状を異にするものである。すなわち、当該屈曲加工においては、各可動部 1 3 a , 1 3 b の基部に円弧状の屈曲部 1 3 a 1 , 1 3 b 1 を形成している。当該基体 1 3 には、図 6 (a) に示すように、各可動部 1 3 a , 1 3 b の外側面に各圧電／電歪素子 1 2 a , 1 2 b を接着することにより、第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b が形成される。

【 0 0 4 4 】

第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各可動部 1 3 a , 1 3 b が円弧状の屈曲部 1 3 a 1 , 1 3 b 1 を介して、固定部 1 3 c および取付部 1 3 d に連結していることから、各可動部 1 3 c , 1 3 d の可動性が向上していて、高いデバイス機能を有するものである。

【 0 0 4 5 】

また、当該第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b においては、可動部 1 3 a , 1 3 b と固定部 1 3 c および取付部 1 3 d に対する垂直度の精度を出し易くして、煽り方向変位を抑えることができる。また、固定部 1 3 c および取付部 1 3 d に対し

て、可動部 1 3 a, 1 3 b の Y 軸方向の位置が円弧状の屈曲部の曲げ方を変えることで設定することができるため、デバイスの設計の幅を広げることができる。

【 0 0 4 6 】

図 1 (c) に示す第 3 圧電／電歪デバイス 1 0 c は、第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは基体の構成のわずかの部位を異にするもので、その他の構成は同じである。しかして、第 3 圧電／電歪デバイス 1 0 c は、図 8 (b) に示すように、基体 1 4 と一対の圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b からなるもので、基体 1 4 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 1 4 a, 1 4 b と、両可動部 1 4 a, 1 4 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 1 4 c と、両可動部 1 4 a, 1 4 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 1 4 d にて構成されている。

【 0 0 4 7 】

基体 1 4 においては、各可動部 1 4 a, 1 4 b の長手方向の中間部が、所定長さにならって薄肉部 1 4 a 1, 1 4 b 1 に形成されているが、この点を除いては基体 1 3 と同一に構成されている。また、基体 1 4 の原板 1 4 A は、図 7 (a) に示すように、各可動部 1 4 a, 1 4 b を構成することとなる、H 形状の開口部 1 4 e の左右の各側部に薄肉部 1 4 a 1, 1 4 b 1 を具備するもので、図 7 (b) に示すように、基体 1 3 と同様に屈曲加工され、図 8 (a) に示すように、各可動部 1 4 a, 1 4 b の外側面に各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b を接着することにより、第 3 圧電／電歪デバイス 1 0 c が形成されている。

【 0 0 4 8 】

第 3 圧電／電歪デバイス 1 0 c は、第 2 圧電／電歪デバイス 1 0 b とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各可動部 1 4 a, 1 4 b がその中間部に長手方向に延びる薄肉部 1 4 a 1, 1 4 b 1 を具備することから、各可動部 1 4 c, 1 4 d の可動性が一層高くて、一層高いデバイス機能を有するものである。

【 0 0 4 9 】

なお、原板 1 4 A の薄肉部 1 4 a 1, 1 4 b 1 を形成する手段としては、化学エッチング、マイクロブラスト、イオンミリング等により部分的に肉を除去して厚みを薄くする方法や、研削により切削して厚みを薄くする方法を採ることがで

きる。また、特殊な場合として、穴を開けた板と穴の無い板を重ねて張り合わせして、穴の部位を薄肉部に形成した板を原板として採用することもできる。

【0050】

図1 (e) に示す第4圧電／電歪デバイス10dは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成を異にするもので、図10 (b) に示すように、基体15と一对の圧電／電歪素子12a, 12bからなり、基体15は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部15a, 15bと、両可動部15a, 15bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部15cと、両可動部15a, 15bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部15dと、各可動部15a, 15bの一端部側上縁から固定部15cの表面に延びて当接する左右一对の補強部15f, 15gにて構成されている。

【0051】

基体15は、各補強部15f, 15gを具備している点を除けば、基体11と同一に構成されている。また、基体15の原板15Aは、図9 (a) に示すように、各可動部15a, 15bを構成することとなる、H形状の開口部15eの左右の各側部に、その一端部側から外方に延びる補強部15f, 15gの構成部位を具備していて、図9 (b) に示すように2点鎖線に沿って屈曲加工され、図10 (a) に示すように、各可動部15a, 15bの外側面に各圧電／電歪素子12a, 12bを接着することにより、第4圧電／電歪デバイス10dが形成されている。

【0052】

第4圧電／電歪デバイス10dは、第1圧電／電歪デバイス10aとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各補強部15f, 15gにより固定部15cを補強しているものである。各補強部15f, 15gは、固定部15c上に接着されているが、その接着手段としては、スポット溶接、圧着、かしめ、半田付け、ロウ付け、エポキシ樹脂、UV硬化型樹脂等の接着剤等による接着手段を採用することができる。これらの接着手段のうちでも、スポット溶接が特に好ましい。

【0053】

図 1 (f) に示す第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e は、第 4 圧電／電歪デバイス 1 0 d とは基体の構成のわずかの部位を異にするもので、その他の構成は同じである。しかして、第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e は、図 1 2 (b) に示すように、基体 1 6 と一対の圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b からなるもので、基体 1 6 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 1 6 a, 1 6 b と、両可動部 1 6 a, 1 6 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 1 6 c と、両可動部 1 6 a, 1 6 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 1 6 d と、各可動部 1 6 a, 1 6 b の各端部から内向きにフランジ状に屈曲する補強部 1 6 f, 1 6 g にて構成されている。

【 0 0 5 4 】

基体 1 6 は、各補強部 1 6 f, 1 6 g の形状が各補強部 1 5 f, 1 5 g の形状とは異なる点を除けば、基体 1 5 と同一に構成されている。また、基体 1 6 の原板 1 6 A は、図 1 1 (a) に示すように、各可動部 1 6 a, 1 6 b を構成することとなる、H 形状の開口部 1 6 e の左右の各側部が前後に所定長さ突出しているもので、図 1 1 (a) に示す 2 点鎖線に沿って同図 (b) に示すように屈曲加工され、図 1 2 (a) に示すように、各可動部 1 6 a, 1 6 b の外側面に各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b を接着することにより、第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e が形成されている。

【 0 0 5 5 】

なお、第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e においては、補強部 1 6 f, 1 6 g は固定部 1 6 c および取付部 1 6 d とは非接着状態にあるが、固定部 1 6 c および取付部 1 6 d 上に接着することが一層好ましい。接着手段としては、スポット溶接、圧着、かしめ、半田付け、ロウ付け、エポキシ樹脂、UV 硬化型樹脂等の接着剤等による接着等の手段を採用することができる。これらの接着手段のうちでも、スポット溶接が特に好ましい。

【 0 0 5 6 】

第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各補強部 1 6 f, 1 6 g により固定部 1 6 c および取付部 1 6 d を補強しているもので

ある。

【0057】

図1 (h) に示す第6圧電／電歪デバイス10fは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体に補強部材を付加した点で異なるが、その他の構成は同じである。しかして、第6圧電／電歪デバイス10fは、図14 (b) に示すように、基体17と一对の圧電／電歪素子12a, 12bからなるもので、基体17は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部17a, 17bと、両可動部17a, 17bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部17cと、両可動部17a, 17bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部17dと、各可動部17a, 17bの一端部側間に介装されて固定部17cの表面に接着された板状の補強部材17fにて構成されている。

【0058】

基体17の原板17Aは、図13 (a) に示すように、基板11の原板11Aと同一形状のもので、図13 (b) に示すように、2点鎖線に沿って屈曲加工され、図14 (a) に示すように、両可動部17a, 17bの一端部側間にて補強部材17fを固定部17cの表面に接着し、かつ、各可動部17a, 17bの外側面に各圧電／電歪素子12a, 12bを接着することにより、第6圧電／電歪デバイス10fが形成されている。第6圧電／電歪デバイス10fは、第4圧電／電歪デバイス10dとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものである。

【0059】

図1 (g) に示す第7圧電／電歪デバイス10gは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成を異にするもので、図16 (b) に示すように、基体18と一对の圧電／電歪素子12a, 12bからなる。基体18は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部18a, 18bと、両可動部18a, 18bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部18cと、両可動部18a, 18bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部18dにて構成されている。固定部18cは、両可動部18a, 18bの一端部側から所定長さ突出し、かつ、取付部18dは、両可動部18a, 18bの他端部側から所定長さ突出している。従って、固

定部 1 8 c および取付部 1 8 d は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a の基体 1 1 における固定部 1 1 c および取付部 1 1 d より拡大されていて、大きな面積に形成されている。

【 0 0 6 0 】

基体 1 8 は、固定部 1 8 c および取付部 1 8 d の面積が拡大されている点を除けば、基体 1 1 と同一に構成されている。また、基体 1 8 の原板 1 8 A は、図 1 5 (a) に示すように、固定部 1 8 c および取付部 1 8 d を構成することとなる、H 形状の開口部 1 8 e の前後の部位が前後に所定長さ突出しているもので、図 1 5 (b) に示すように 2 点鎖線に沿って屈曲加工され、図 1 6 (a) に示すように、各可動部 1 8 a , 1 8 b の外側面に各圧電／電歪素子 1 2 a , 1 2 b を接着することにより、第 7 圧電／電歪デバイス 1 0 g が形成されている。

【 0 0 6 1 】

第 7 圧電／電歪デバイス 1 0 g は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、固定部 1 8 c および取付部 1 8 d を拡大して、サスペンションのジンバルへの接着面積の拡大、および、ハードディスクドライブの磁気ヘッド等の被制御部品に対する接着面積の拡大を図ることができる。

【 0 0 6 2 】

図 1 (d) に示す第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは基体の構成を大きく異にするものである。しかして、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a は図 1 8 (b) に示すように、基体 2 1 と一対の圧電／電歪素子 2 2 a , 2 2 b からなるもので、基体 2 1 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 2 1 a , 2 1 b と、両可動部 2 1 a , 2 1 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 2 1 c にて構成されている。但し、両可動部 2 1 a , 2 1 b の他端部側には、取付部は具備していない。

【 0 0 6 3 】

当該基体 2 1 の原板 2 1 A は、図 1 7 (a) に示すように、平板を打抜き加工して門形状の開口部 2 1 d を形成されているものである。開口部 2 1 d は、平板の左右の側部にて前後両端部側に延びる一対の直線状の側方溝部 2 1 d 1 , 2

1 d 2 と、これら両溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 間の他端部側を切欠いた開口部位 2 1 d 3 を備えた形状のものである。基体 2 1 は、原板 2 1 A の左右の各側部を、各側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 にて、同図 (b) に示すように、同溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 の幅の中心をその長手方向に延びる中心線 L 1, L 2 に沿って直角に屈曲加工することにより形成されている。原板 2 1 A の左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 の側縁部位が各可動部 2 1 a, 2 1 b に形成されるとともに、両側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 間の部位が固定部 2 1 c に形成される。

【0064】

このように、原板 2 1 A にて一体に構成された基体 2 1 には、図 1 8 (a) に示すように、その各可動部 2 1 a, 2 1 b の外側面に圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b を接着剤を介して接着されて、同図 (b) に示す圧電／電歪デバイス 2 0 a が形成される。形成された圧電／電歪デバイス 2 0 a は、両可動部 2 1 a, 2 1 b の他端部側の間にヘッド等の被制御部品を接着した状態で使用されて、従来のこの種形式の圧電／電歪デバイスと同様に機能するものであるが、基体 2 1 が原板 2 1 A にて一体的に構成されていることから、下記のごとき作用効果を奏するものである。

【0065】

すなわち、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a においては、基体 2 1 が原板 2 1 A からなる一体構造のもので 1 個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体 2 1 と圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b の 2 種類となり、圧電／電歪デバイス 2 0 の構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【0066】

また、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a においては、構成部品の部品点数が極めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性有するものとなる。

【0067】

また、第8圧電／電歪デバイス20aにおいては、その形成にあつては、従来のごとくデバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃、その他の汚染物の付着に起因する汚染がない。このため、第8圧電／電歪デバイス20の組立てに際して、予め、基体21および圧電／電歪素子22a、22bを洗浄しておけば、組立てられた圧電／電歪デバイス20は汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイス20aの洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができるという大きな利点がある。

【0068】

第8圧電／電歪デバイス20aに対する被制御部品等の取付けは、両可動部21a、21bの先端側内面21a1、21b1に接着剤を介して固定することによって行う。この場合、当該圧電／電歪デバイス20aの変形例である後述する圧電／電歪デバイス20cを示す図19を参照すれば明らかなように、デバイス20aの高さH1が部品の高さH2より低いときには、デバイス20aと部品を組立た状態での高さH3は、部品の高さH2と同じ（ $H3=H2$ ）になってデバイス20aの高さH1を無視することができ、本発明の他の形態の圧電／電歪デバイスに比較して、さらに省スペース化をすることができる利点がある。

【0069】

なお、当該組立構造では、部品を両可動部21a、21bで挟む構造であるため、両可動部21a、21bにおける先端側内面21a1、21b1の間隔を、部品の幅と介在させる接着剤層の厚みを含めた幅寸法と同等に設定しておく必要がある。これを怠ると、両可動部21a、21bの先端側内面21a1、21b1の間隔が狭すぎる場合には、部品が先端側内面21a1、21b1間に配置できずに組立不能となり、これとは逆に、両可動部21a、21bの先端側内面21a1、21b1の間隔が広すぎる場合には、部品が先端側内面21a1、21b1の両者に接着できずに組立不能となる。

【0070】

また、当該組立構造を採る場合、両可動部21a、21bの先端側内面21a1、21b1の間隔を、部品が配置できて先端側内面21a1、21b1の両者に接

着できる幅寸法に設定し得たとしても、部品を各先端側内面 2 1 a 1, 2 1 b 1 に接着させる接着剤層の厚みがばらつくと、両可動部 2 1 a, 2 1 b の変位共振が変化してデバイス特性にばらつきが生じる原因となる。このため、基体 2 1 の形成時の屈曲加工では、高精度のプレス成形手段を採ることにより、高精度に屈曲加工した基体 2 1 を大量に作成し得るようにしている。これにより、部品を各先端側内面 2 1 a 1, 2 1 b 1 に接着させる接着剤層の厚みのばらつきを極力少なくして、デバイス特性のばらつきが極めて小さい品質のものとしている。

【 0 0 7 1 】

図 1 9 には、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a を変形した第 1 の変形例である圧電／電歪デバイス 2 0 c を示している。当該圧電／電歪デバイス 2 0 c は、圧電／電歪デバイス 2 0 a とは基本構成を同じくするもので、可動部 2 1 a, 2 1 b の先端部が内側に折曲げられている点でのみ、圧電／電歪デバイス 2 0 a とは構成を異にしている。すなわち、各可動部 2 1 a, 2 1 b は、先端部に折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 を有するものである。各折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 は、可動部 2 1 a, 2 1 b の先端部を内側へほぼ 1 8 0 度折曲げられて形成されているもので、折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 の内側面は互いに対向していて、これら両内側面が被制御部品 H の取付部位となっている。被制御部品 H は、適宜の接着剤を介して折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 の内側面に接着して取付けられる。

【 0 0 7 2 】

なお、当該圧電／電歪デバイス 2 0 c のその他の構成は圧電／電歪デバイス 2 0 a と同じであるため、同一の構成部材および同一の構成部位については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【 0 0 7 3 】

しかして、当該圧電／電歪デバイス 2 0 c においては、被制御部品 H に対する接着長さおよび接着面積を、両折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 により規定することができて、個々のデバイス間での被制御部品 H の接着長さおよび接着面積のばらつきを効果的に解消することができる。これにより、被制御部品 H の接着長さおよび接着面積のばらつきに起因する、デバイス個々の変位共振の値のばらつきを解消することができる。

【0074】

なお、当該圧電／電歪デバイス20cにおいては、第8圧電／電歪デバイス20aの作用効果で述べているように、デバイス20cの高さH1が部品の高さH2より低いため、デバイス20cに部品Hを組立た状態での高さH3は、部品の高さH2と同じ（ $H3=H2$ ）になってデバイス20の高さH1を無視することができ、本発明の他の形態の圧電／電歪デバイスに比較して、さらに省スペース化をすることができる利点がある。

【0075】

図20には、第8圧電／電歪デバイス20aを変形した第2の変形例である圧電／電歪デバイス20dを示している。当該圧電／電歪デバイス20dは、圧電／電歪デバイス20aとは基本構成を同じくするもので、可動部21a、21bが段付きの細帯状板に形成されており、可動部21a、21bの先端部が主体部よりわずかに内側に偏倚した屈折部21a3、21b3となっている。可動部21a、21bの屈折部21a3、21b3は互いに対向して位置していて、圧電／電歪デバイス20cにおける両折曲部21a2、21b2と同様に、これらの屈折部21a3、21b3の両内側面が被制御部品Hの取付部位となっている。被制御部品Hは、適宜の接着剤を介して屈折部21a3、21b3の内側面に接着して取付けられている。従って、当該圧電／電歪デバイス20dは、圧電／電歪デバイス20cと同様に機能して、同様の作用効果を奏するものである。なお、当該圧電／電歪デバイス20dのその他の構成は、圧電／電歪デバイス20cと同じ構成であるため、圧電／電歪デバイス20cと同一の構成部材および同一の構成部位は、圧電／電歪デバイス20cと同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【0076】

図1(i)に示す第9圧電／電歪デバイス20bは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成を大きく異にするものである。しかして、第9圧電／電歪デバイス20bは図22(b)に示すように、基体23と一对の圧電／電歪素子22a、22bからなるもので、基体23は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部23a、23bと、両可動部23a、23bを一端部側にて互いに連結する

平板状で細幅の固定部 2 3 c と、両可動部 2 3 a, 2 3 b を他端部側にて互いに連結する平板状で細幅の取付部 2 3 d にて構成されている。

【 0 0 7 7 】

当該基体 2 3 の原板 2 3 A は、図 2 1 (a) に示すように、平板を打抜き加工して略正方形の開口部 2 3 e を形成されているものである。基体 2 3 は、原板 2 3 A の左右の各側部を、開口部 2 3 e の各開口縁部にて、同図 (b) に示すように、同開口縁部の沿って長手方向に延びる中心線 L1, L2 に沿って直角に屈曲することにより形成されている。原板 2 3 A の左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各開口縁部の側縁部位が各可動部 2 3 a, 2 3 b に形成されているとともに、両開口縁部の側縁部位間が固定部 2 3 c および取付部 2 3 d に形成されている。

【 0 0 7 8 】

このように、原板 2 3 A にて一体に構成された基体 2 3 には、図 2 2 (a) に示すように、その各可動部 2 3 a, 2 3 b の外側面に圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b を接着剤を介して接着されて、同図 (b) に示す圧電／電歪デバイス 2 0 b が形成される。組立てられた圧電／電歪デバイス 2 0 b は、従来のこの種形式の圧電／電歪デバイスと同様に機能するものであるが、基体 2 3 が原板 2 3 A にて一体的に構成されていることから、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a および第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a と略同様の作用効果を奏するものである。

【 0 0 7 9 】

第 9 圧電／電歪デバイス 2 0 b は、固定部 2 3 c および取付部 2 3 d が小さくてアクチュエータや被制御部品に対する接着面積が小さいが、たとえば、スポット溶接のように小さい接着面積で部品を強固に接合できる手段を採ることができる場合には、大きい固定部や取付部は余計な錘り（質量）として作用することになる。当該第 9 圧電／電歪デバイス 2 0 b は、この点で他の圧電／電歪デバイス 1 0 a ～ 1 0 g とは相違し、余計な質量が無い分、共振周波数を高く設定することができて、アクチュエータの動作を高速化することができる利点がある。

【 0 0 8 0 】

上記した各実施形態に係る圧電／電歪デバイス 1 0 a ～ 1 0 g, 2 0 a ～ 2 0

dにおいては、各基体11~18, 21, 23を形成する原板として、打抜き加工してなる打抜構造体を採用しているが、これらの原板の各開口部11e~18e, 21d, 23eについては、所定形状に打抜かれた原板を打抜き手段以外の手段、例えば、レーザー加工、放電加工、ドリル加工、超音波加工、エッチング等の穴開け加工手段にて形成するようにすることができる。これらの穴開け加工手段においては、エッチング以外の手段では、穴加工端面にバリが発生する場合があるが、バリはエッチング処理やブラスト処理にて簡単に除去することができる。

【0081】

また、各圧電／電歪デバイス10a~10g, 20a~20dの基体11, 13~18, 21, 23を構成する可動部11a, 11b…の折曲げ角度は、固定部および取付部に対してほぼ垂直とすることが好ましく、 90 ± 10 度、好ましくは 90 ± 5 度、より好ましくは 90 ± 1 度とする。可動部11a, 11b…の折曲げ角度が90度からずれると、煽り方向の変位が大きくなる。なお、上記した符号…は、対応する部位の他の符号を省略したことを意味するもので、記載を簡略にするため、以下同様に使用することがある。

【0082】

屈曲加工されて形成された基体11~18, 21, 23については、洗剤、有機溶剤等を使用する超音波洗浄に付することが好ましい。超音波洗浄においては、パワーを強くしても基体が破壊するようなことがないため、パワーの強い超音波洗浄により汚れを簡単に除去することができる。

【0083】

また、各圧電／電歪デバイス10a~10g, 20a~20dでは、基体と圧電／電歪素子をそれぞれ別体に形成して、各圧電／電歪素子を基体の可動部に接着することにより構成しているが、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、基体に形成する前の原板の可動部となる部位、または、基体の可動部に、圧電／電歪層および電極をスパッタ、CVD、MBE等の手段で成膜したり、ゾルゲル法にて成膜することにより、圧電／電歪素子を基体に直接形成することができる。

【0084】

上記した各実施形態に係る圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dを構成する圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bは、圧電／電歪層とこれに電界を印加するための一対の電極を備えるもので、ユニモルフ型、バイモルフ型等の圧電／電歪素子である。なかでも、ユニモルフ型の圧電／電歪素子は、派生する変位の安定性に優れ、かつ、軽量化にとって有利であることから、圧電／電歪デバイスの構成部品として適している。

【0085】

図23および図24には、圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dを構成する圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bに好適に採用される数例の圧電／電歪素子31～34を示している。

【0086】

図23(a)に示す圧電／電歪素子31は、圧電／電歪層が1層である1層構造のもので、圧電／電歪層31a、上下一対の第1, 第2電極31b, 31c、および、一対の端子31d, 31eにて構成されている。同図(b)に示す圧電／電歪素子32は、圧電／電歪層が2層である2層構造のもので、圧電／電歪層32a, 32b、両圧電／電歪層32a, 32b間に介在する第1電極32c、両圧電／電歪層32a, 32bの外側面を包囲する第2電極32d、および、一対の端子32e, 32fにて構成されている。

【0087】

また、図24に示す圧電／電歪素子33, 34は、圧電／電歪層が4層である4層構造のものである。同図(a)に示す圧電／電歪素子33は、圧電／電歪層33a, 33b, 33c, 33d、これらの両圧電／電歪層間に介在し包囲する第1, 第2電極33e, 33f、および、一対の端子33g, 33hにて構成されている。また、同図(b)に示す圧電／電歪素子34は、圧電／電歪素子33とは端子の配設部位を異にするもので、圧電／電歪層34a, 34b, 34c, 34d、これらの両圧電／電歪層間に介在し包囲する第1, 第2電極34e, 34f、および、一対の端子34g, 34hにて構成されている。これらの各圧電／電歪素子31～34は、各圧電／電歪デバイスの圧電／電歪素子12a, 12

b、22a、22bとして、圧電／電歪デバイスの用途に応じて適宜採用されるものである。

【0088】

各圧電／電歪素子31～34を構成する圧電／電歪層には圧電セラミックスが用いられるが、電歪セラミックス、強誘電セラミックス、反強誘電セラミックス等を用いることも可能である。但し、圧電／電歪デバイスをハードディスクドライブの磁気ヘッド位置決め等に使用する場合には、取付部の変位量と駆動電圧または出力電圧とのリニアリティが重要となることから、歪み履歴の小さい材料を用いることが好ましい。抗電界が10kV/mm以下の材料を用いることが好ましい。

【0089】

圧電／電歪層を形成するための材料としては、具体的には、ジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ酸鉛、マンガンニオブ酸鉛、アンチモンスズ酸鉛、マンガンタングステン酸鉛、コバルトニオブ酸鉛、チタン酸バリウム、チタン酸ナトリウムビスマス、ニオブ酸カリウムナトリウム、タンタル酸ストロンチウムビスマス等の単独、または、これらの適宜の混合物等を挙げることができる。特に、ジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛を主成分とする材料、または、チタン酸ナトリウムビスマスを主成分とする材料が好適である。

【0090】

圧電／電歪層を形成するための材料には、適宜の材料を添加して、圧電／電歪層の特性を調整することができる。添加材としては、ランタン、カルシウム、ストロンチウム、モリブデン、タングステン、バリウム、ニオブ、亜鉛、ニッケル、マンガン、セシウム、カドミウム、クロム、コバルト、アンチモン、鉄、イットリウム、タンタル、リチウム、ビスマス、スズ等の酸化物、または、最終的に酸化物となる材料の単独、もしくは、これらの適宜の混合物等を挙げることができる。

【0091】

例えば、主成分であるジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛等

に、ランタンやストロンチウムを含有させることにより、抗電界や圧電特性を調整し得る利点がある。なお、シリカ等のガラス化し易い材料の添加は避けるべきである。何故ならば、シリカ等のガラス化し易い材料は、圧電／電歪層の熱処理時に圧電／電歪層と反応し易く、その組成を変化させて圧電特性を劣化させるからである。

【0092】

各圧電／電歪素子31～34を構成する電極は、室温で固体であって、導電性に優れた金属材料で形成されることが好ましい。金属材料としては、アルミニウム、チタン、クロム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン、ルテニウム、パラジウム、ロジウム、銀、スズ、タンタル、タングステン、イリジウム、白金、金、鉛等の金属の単体、または、これら金属の合金等を挙げることができる。また、これらの金属材料に圧電／電歪層と同じ材料または異なる材料のセラミックスを分散させてなるサーメット材料を用いることもできる。

【0093】

各圧電／電歪素子31～34は、圧電／電歪層と各電極を互いに積層した状態で、一体的に焼成することにより形成されることが好ましい。この場合には、電極としては、白金、パラジウム、またはこれらの合金等の高融点金属材料からなるもの、高融点金属材料と圧電／電歪層の形成材料や他のセラミックス材料との混合物であるサーメット材料からなる電極を採用することが好ましい。電極の厚みは、圧電／電歪素子の変位に影響を及ぼす要因になることから、極力薄い薄膜状であることが好ましい。このため、圧電／電歪層と一体に焼成されて形成される電極が極力薄い薄膜状となるためには、電極を形成する材料は金属ペースト、例えば金レジネートペースト、白金レジネートペースト、銀レジネートペースト等の形態で使用する方が好ましい。

【0094】

各圧電／電歪素子31～34の厚みは、各実施形態の圧電／電歪デバイスの圧電／電歪素子12a、12b、22a、22bとして使用する場合には、 $40\mu\text{m}$ ～ $180\mu\text{m}$ の範囲が好ましい。厚みが $40\mu\text{m}$ 未満である場合には、取扱い中に破損し易く、また、厚みが $180\mu\text{m}$ を越える場合には、デバイスの小型化

が困難となる。また、圧電／電歪素子は、圧電／電歪素子 3 3, 3 4 のごとく多層構造とすることによりその出力を増加させて、デバイスの変位の拡大を図ることができる。また、圧電／電歪素子を多層構造とすることにより、デバイスの剛性が向上することから、デバイスの共振周波数が高くなって、デバイスの変位動作を高速化できる利点がある。

【 0 0 9 5 】

各圧電／電歪素子 3 1 ~ 3 4 は、圧電／電歪層と電極層を印刷またはテープ成形により積層して焼成してなる大面積の原板を、ダイサー、スライサー、ワイヤーソウ等により所定寸法に多数個切出す手段で作成される。圧電／電歪素子 3 1 ~ 3 4 は、公知のセラミックス基体に比較して薄くて硬度が低いため、原板の切削速度を速く設定できて高速で大量に加工処理できる。

【 0 0 9 6 】

各圧電／電歪素子 3 1 ~ 3 4 は、単純な板状構造であって取扱いが容易であり、また、表面積が小さいため汚れの付着量が少なくて汚れを除去し易い。但し、圧電／電歪素子は、セラミックス材料を主体とすることから、超音波洗浄では、適切な洗浄条件を設定する必要がある。原板から切出された圧電／電歪素子においては、US 洗浄で精密洗浄した後、大気中、1 0 0 °C ~ 1 0 0 0 °C で熱処理されて、微細な気孔に入り込んでいる水分と有機物を完全に除去される。

【 0 0 9 7 】

各実施形態に係る圧電／電歪デバイス 1 0 a ~ 1 0 g, 2 0 a ~ 2 0 d を構成する圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b, 2 2 a, 2 2 b として、各圧電／電歪素子 3 1 ~ 3 4 を採用した場合の基体に対する接着手段としては、エポキシ樹脂、UV 樹脂、ホットメルト接着剤等の樹脂系接着剤や、ガラス、セメント、半田、ロウ材等の無機系の接着剤を使用することが好ましく、また、樹脂系接着剤に金属粉末やセラミックス粉末を混合したものを使用することもできる。接着剤の硬度はショア D で 8 0 以上が好ましい。

【 0 0 9 8 】

なお、基体における圧電／電歪素子を接着する表面部位には、予め、ブラスト、エッチング、めっき等の粗面加工を施しておくことが好ましい。接着部位の表

面粗さを $Ra = 0.1 \mu m \sim 5 \mu m$ 程度にすることにより、接着面積を広げて接着強度を向上させることができる。この場合、圧電／電歪素子側の接着部位の表面も粗い方が好ましい。電極を基体とは導通させたくない場合には、最下層の圧電／電歪層の表面に電極を配置しないようにする。接着剤として、半田、ろう材を用いる場合には、濡れ性をよくするために、圧電／電歪素子の表面金属材料の電極層を配置することが好ましい。接着剤の厚みは、 $1 \mu m \sim 50 \mu m$ の範囲であることが好ましい。接着剤の厚みは、薄い方がデバイスの変位および共振特性のばらつきを減らす点、および省スペース化の点で好ましいが、接着強度、変位、共振等の特性を確保するためには、採用する接着剤毎に最適の厚みを設定するようにする。

【0099】

基体に圧電／電歪素子を接着する際には、圧電／電歪素子の電極が基体の固定部側となるようにして、圧電／電歪素子が固定部の屈曲位置に完全にかかるように接着する。圧電／電歪素子は、基体の固定部側の端部と一致させて接着することが好ましいが、圧電／電歪素子の端子と外部端子との接続を容易にするために、圧電／電歪素子を基体の端部から外方へ突出させて接着してもよい。但し、圧電／電歪素子は、金属製である基体に比較して破損し易いので、取扱いに注意が必要である。

【0100】

図25は、第1の実施形態に係る第1圧電／電歪デバイス10aにおいて、各圧電／電歪素子12a、12bとして圧電／電歪素子34を採用した例を示している。以下では、当該実施形態の第1圧電／電歪デバイス10aを本発明に係る圧電／電歪デバイスの基本構成を有する代表例として、主として、当該第1圧電／電歪デバイス10aに基づいてその構成や作動等について説明する。

【0101】

当該圧電／電歪デバイス10aにおいて、圧電／電歪素子34の一部が基体11の固定部11cに位置する場合、図26に示すように、一対の可動部11a、11bにおける取付部11dとの境界部と固定部11cとの境界部間の最短距離を L_a とし、取付部11dと可動部12a、12bとの境界部分から圧電／電歪

素子 3 4 の各電極 3 4 e, 3 4 f のいずれかの端部までの短い方の距離を L_b とするとき、 $(1 - L_b / L_a)$ が 0.4 以上であることが好ましく、一層好ましくは 0.5 ~ 0.8 である。この値が 0.4 未満である場合には、デバイスの変位を大きくとれない。この値が 0.5 ~ 0.8 である場合には、デバイスの変位と共振の両立を達成し易い。この場合、可動部 1 2 a, 1 2 b の一方にのみ、圧電／電歪素子 3 4 を接着する構成を採ることもでき、より好ましい実施形態といえることができる。なお、圧電／電歪素子 3 4 の一部が取付部 1 1 d の一部に位置する場合も同様である。

【0102】

当該圧電／電歪デバイス 1 0 a において、両圧電／電歪素子 3 4 の各電極 3 4 e, 3 4 f への電圧の印加は、各端子 3 4 g, 3 4 h を通して行われる。各端子 3 4 g, 3 4 h の位置は、一方の電極 3 4 e に対する端子 3 4 g が固定部 1 1 c の後ろよりに形成され、他方の電極 3 4 h に対する端子 3 4 h は固定部 1 1 c の内壁よりに形成されている。いずれかの端子 3 4 g, 3 4 h は、基体 1 1 と導通させることで、基体 1 1 のアースと共有させて省略することができる。接着する圧電／電歪素子 3 4 の幅は、基体 1 1 の接着部（可動部 1 1 a, 1 1 b の接着部位）の幅と同一である必要はなく、異なってもデバイスの機能上何等問題はない。

【0103】

当該圧電／電歪デバイス 1 0 a は、例えば、基体 1 1 を板厚 $40\ \mu\text{m}$ の SUS 3 0 4 で形成されて、全長 1.9 mm、全幅 1.5 mm の大きさに形成される。圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b として採用している圧電／電歪素子 3 4 は、P Z T を使用した 4 層構造体であって、圧電／電歪層 3 4 a ~ 3 4 d の 1 層の厚みが $15\ \mu\text{m}$ 、各電極 3 4 e, 3 4 f は $3\ \mu\text{m}$ の白金、各端子 3 4 g, 3 4 h は金ペーストからなる薄膜である。各圧電／電歪素子 3 4 は、1 液の熱硬化エポキシ樹脂接着剤で各可動部 1 1 a, 1 1 b の外側面に接着される。

【0104】

このような大きさに構成した当該圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、圧電／電歪素子 3 4 を駆動電圧 $20 \pm 20\ \text{V}$ の 1 kHz の正弦波で駆動させた場合の

取付部 1 1 d の変位を測定したところ、 $\pm 1.5 \mu\text{m}$ であった。また、正弦波電圧 $\pm 0.5 \text{ V}$ として周波数を掃引して変位の最大値を示す共振周波数を測定したところ、 45 kHz であった。

【0105】

次に、本発明に係る圧電／電歪デバイスの動作を、上記した第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a に基づいて説明する。

【0106】

当該圧電／電歪デバイス 1 0 a において、各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b (3 4) に電圧が印加されていない非作動時には図 2 6 に示す状態にあり、圧電／電歪デバイス 1 0 a の長軸 m (固定部 1 1 c の長軸) と取付部 1 1 d の中心軸 n とはほぼ一致している。この状態で、例えば、図 2 7 (a) の波形図に示すように、一方の圧電／電歪素子 1 2 b における一対の電極 3 4 e, 3 4 f に所定のバイアス電位 V_b を有するサイン波 W_b をかけ、同図 (b) に示すように、他方の圧電／電歪素子 1 2 a における一対の電極 3 4 e, 3 4 f に、前記サイン波 W_b とはほぼ 180 度位相の異なるサイン波 W_a をかける。

【0107】

しかして、一方の圧電／電歪素子 1 2 b における一対の電極 3 4 e, 3 4 f に対して、例えば、最大値の電圧が印加された段階では、一方の圧電／電歪素子 1 2 b における圧電／電歪層 3 4 a ~ 3 4 d は、その主面方向に収縮変位する。

【0108】

これにより、当該圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、例えば図 2 8 に示すように、一方の可動部 1 1 b に対して図示右方向 (矢印 A 方向) に撓ませる応力が発生することから、可動部 1 1 b は同方向に撓む。この場合、他方の圧電／電歪素子 1 2 a における一対の電極 3 4 e, 3 4 f は、電圧が印加されない状態になるため、他方の可動部 1 1 a は一方の可動部 1 1 b の撓みに追従して、可動部 1 1 b と同方向へ撓む。この結果、両可動部 1 1 a, 1 1 b は、圧電／電歪デバイス 1 0 a の長軸 m に対して、図示右方向へ変位する。この変位の変位量は、各圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b に対する印加電圧の最大値に応じて変化する。電圧の最大値が大きくなるほど、変位量は大きくなる。

【0 1 0 9】

特に、圧電／電歪素子 3 4 を構成する圧電／電歪層 3 4 a ~ 3 4 d の構成材料として、高い抗電界を有する圧電／電歪材料を採用した場合には、図 2 7 (a), (b) の 2 点鎖線の波形に示すように、最小値のレベルがわずかに負のレベルとなるように、前記バイアス電位を調整するようにしてもよい。この場合、負のレベルのバイアス電位が印加されている圧電／電歪素子、例えば、他方の圧電／電歪素子 1 2 a の駆動によって、例えば、他方の可動部 1 1 a に一方の可動部 1 1 b の撓み方向と同方向の応力が発生し、取付部 1 1 d の変位量をより大きくすることが可能となる。換言すれば、図 2 7 (a), (b) におけるの 2 点鎖線で示す波形を使用することにより、負のレベルのバイアス電位が印加されている圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b は、変位動作の主体となっている圧電／電歪素子 1 2 b, 1 2 a をサポートするという機能を持たせることができる。

【0 1 1 0】

このように、当該圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b の微小な変位が、両可動部 1 1 a, 1 1 b の撓みを利用して大きな変位動作に増幅されて両可動部 1 1 a, 1 1 b に伝達されることになるため、取付部 1 1 d は、圧電／電歪デバイス 1 0 a の長軸 m に対して大きく変位させることが可能となる。

【0 1 1 1】

当該圧電／電歪デバイス 1 0 a においては、その機能を一層確実に発揮させるためには、下記のごとく配慮することが好ましい。すなわち、取付部 1 1 d の変位動作を確実なものとするために、圧電／電歪素子 1 2 a, 1 2 b の実質的駆動部分 L c が固定部 1 1 c または取付部 1 1 d にかかる距離 L d を、可動部 1 1 a, 1 1 b の厚み b の $1/2$ 以上とすることが好ましい。また、可動部 1 1 a, 1 1 b の内壁間の距離 c (X 軸方向の距離) と可動部 1 1 a, 1 1 b の幅 d (Y 軸方向の距離) との比 c/d が 0.5 ~ 2.0 となるように構成する。当該比 c/d は、好ましくは 1 ~ 1.5 であり、さらに好ましくは 1 ~ 1.0 である。当該比 c/d の規定値は、取付部 1 1 d の変位量を大きくし、X 軸 - Z 軸平面内での変位を支配的に得られることを知得したことに基づく規定である。

【0112】

全長さ e_0 の可動部11a, 11bにおける実質的な可動長さ e （Z軸方向の距離）と、可動部11a, 11bの内壁間の距離 c との比 e/c は、好ましくは0.5～10であり、さらに好ましくは0.5～5である。取付部11dと可動部11a, 11bとの連結部の長さ f_1 （Z軸方向の距離）、固定部11cと可動部11a, 11bとの連結部の長さ f_2 （Z軸方向の距離）は、短いことが好ましい。取付部11dを短くすることにより、デバイスの軽量化と共振周波数の増大を図ることができる。しかしながら、取付部11dのX軸方向の剛性を確保して、その変位を確実なものとするには、可動部11a, 11bの厚み b との比 f_1/b , f_2/b を2以上、好ましくは5以上とすることが好ましい。また、基体11の屈曲位置L1から可動部12aまでの距離 e_{1x} 、L1から固定部11cまたは取付部11dまでの距離 e_{1y} は、 $(e_{1x}/b) > 1$ 、 $(e_{1y}/b) > 1$ であって、それぞれ2以上であることが好ましい。

【0113】

当該圧電／電歪デバイス10aの各部位の実寸法は、部品を取付けるための取付部11dの接着面積、固定部11cを他の部材へ取付けるための接着面積、電極用の端子等の取付けのための接着面積、デバイス全体の強度、耐久性、必要な変位量および共振性、駆動電圧等を考慮して設定することが肝要である。

【0114】

具体的には、例えば、可動部11a, 11bの内壁間の距離 c は、好ましくは $100\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $200\mu\text{m} \sim 1600\mu\text{m}$ である。可動部11a, 11bの幅 d は、好ましくは $50\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $100\mu\text{m} \sim 500\mu\text{m}$ である。可動部11a, 11bの厚み b は、Y軸方向への変位成分である煽り変位が効果的に抑制できるように、可動部11a, 11bの幅 d との関係が $d > b$ であって、好ましくは $2\mu\text{m} \sim 300\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $10\mu\text{m} \sim 80\mu\text{m}$ である。

【0115】

可動部11a, 11bにおける実質的な可動長さ e は、好ましくは $200\mu\text{m} \sim 3000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $300\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ である。取付部1

1 dと可動部11 a, 11 bとの連結長さf1、固定部11 cと可動部11 a, 11 bとの連結長さf2は、好ましくは $50\mu\text{m}$ ～ $2000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $100\mu\text{m}$ ～ $1000\mu\text{m}$ である。

【0116】

基体11の屈曲位置L1から可動部12 aまでの距離e1xは、好ましくは $1\mu\text{m}$ ～ $300\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $5\mu\text{m}$ ～ $80\mu\text{m}$ である。また、基体11の屈曲位置L1から固定部11 cまたは取付部11 dまでの距離e1yは、好ましくは $1\mu\text{m}$ ～ $1000\mu\text{m}$ 、好ましくは $5\mu\text{m}$ ～ $500\mu\text{m}$ である。なお、基体11の屈曲位置L2から可動部12 aまでの距離（距離e1xに対応する距離）、および、基体11の屈曲位置L2から固定部11 cまたは取付部11 dまでの距離（距離e1yに対応する距離）は、距離e1xおよび距離e1yと同様である。

【0117】

当該圧電／電歪デバイス10 aをこのように構成することにより、X軸方向の変位に対するY軸方向の変位を10%を超えないようにすることができるが、上記した寸法比率と実寸法の範囲内で適宜設定することにより低電圧での駆動が可能であり、X軸方向の変位に対するY軸方向の変位を5%以下に抑制し得るという優れた効果を奏する。換言すれば、取付部11 dは、実質的にX軸方向の1軸方向に変位することになって、高速応答性に優れ、低電圧で大きな変位が得られるという優れた特性を有する。

【0118】

また、当該圧電／電歪デバイス10 aにおいては、その主要構成部材である基体11が特有の形状を呈していて、可動部11 a, 11 bが固定部11 cおよび取付部11 dに対してほぼ直交状態にあって、リブのごとく機能するため、デバイスのY軸方向の剛性を高く設定することができる。このため、当該圧電／電歪デバイス10 aにおいては、取付部11 dの動作を平面内（X軸－Z軸平面内）のみに選択的に発生させることができ、取付部11 dのY軸－Z軸平面内での動作、所謂、煽り方向の動作を抑制することができる。

【0119】

なお、本発明に係るデバイスにおいては、基体の固定部と取付部の形状を工夫

することにより、ハードディスクドライブのサスペンションのジンバルと、デバイスの基体を一体化することも可能である。

【0 1 2 0】

なお、図 2 9 および図 3 0 には、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a の 2 つの変形例を示している。これらの両変形例に係る圧電／電歪デバイス 1 0 a 1, 1 0 a 2 は、基本的には、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a と同一構成であるが、圧電／電歪デバイス 1 0 a 1 においては、基体 1 1 の固定部 1 1 c および取付部 1 1 d のほぼ中央部に、円形状の窪み部 1 1 c 1, 1 1 d 1 がプレス成形にて形成されており、また、圧電／電歪デバイス 1 0 a 2 においては、基体 1 1 の固定部 1 1 c および取付部 1 1 d のほぼ中央部に、円形状の貫通穴 1 1 c 2, 1 1 d 2 が打ち抜き加工にて形成されている。

【0 1 2 1】

圧電／電歪デバイス 1 0 a 1 においては、基体 1 1 の固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に設けた窪み部 1 1 c 1, 1 1 d 1 は、固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に取付けられる部品を接着するための接着剤を収容すべく機能するもので、窪み部 1 1 c 1, 1 1 d 1 に収容された接着剤により部品に対する接着強度を増加させることができるとともに、接着剤の接着部位からのはみ出しを防止することができる。

【0 1 2 2】

また、圧電／電歪デバイス 1 0 a 2 においては、基体 1 1 の固定部 1 1 c および取付部 1 1 d に設けた貫通穴 1 1 c 2, 1 1 d 2 は、固定部 1 1 c および取付部 1 1 d への部品の組立（接着）の際の位置決め基準として機能するもので、後工程での組立精度を向上させて、製品の歩留まりを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明に係る圧電／電歪デバイスである 9 種類の実施形態を示す斜視図 (a) ～ (i) である

【図 2】 第 1 の実施形態である第 1 圧電／電歪デバイスの被制御部品を搭載した状態の斜視図である。

【図 3】 第 1 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および

同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 4】第 1 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 5】第 2 の実施形態である第 2 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 6】第 2 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 7】第 3 の実施形態である第 3 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 8】第 3 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 9】第 4 の実施形態である第 4 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 10】第 4 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 11】第 5 の実施形態である第 5 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 12】第 5 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 13】第 6 の実施形態である第 6 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 14】第 6 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 15】第 7 の実施形態である第 7 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板

の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 16】第 7 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 17】第 8 の実施形態である第 8 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 18】第 8 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 19】第 8 圧電／電歪デバイスの第 1 の変形例を示す被制御部品を搭載した状態の斜視図である。

【図 20】第 8 圧電／電歪デバイスの第 2 の変形例を示す斜視図である。

【図 21】第 9 の実施形態である第 8 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図 (a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図 (b) である。

【図 22】第 9 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図 (a)、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図 (b) である。

【図 23】本発明に係る圧電／電歪デバイスを構成する圧電／電歪素子に採用される 2 例の各圧電／電歪素子の斜視図 (a)、(b) である。

【図 24】本発明に係る圧電／電歪デバイスを構成する圧電／電歪素子に採用される他の 2 例の各圧電／電歪素子の斜視図 (a)、(b) である。

【図 25】圧電／電歪素子として図 23 (b) に示す圧電／電歪素子を採用してなる第 1 圧電／電歪デバイスの斜視図である。

【図 26】同圧電／電歪デバイスの非作動状態の平面図である。

【図 27】同圧電／電歪デバイスの各圧電／電歪素子に印加される電圧の波形図である (a)、(b) である。

【図 28】同圧電／電歪デバイスの作動状態の平面図である。

【図 29】第 1 圧電／電歪デバイスの第 1 の変形例を示す斜視図である。

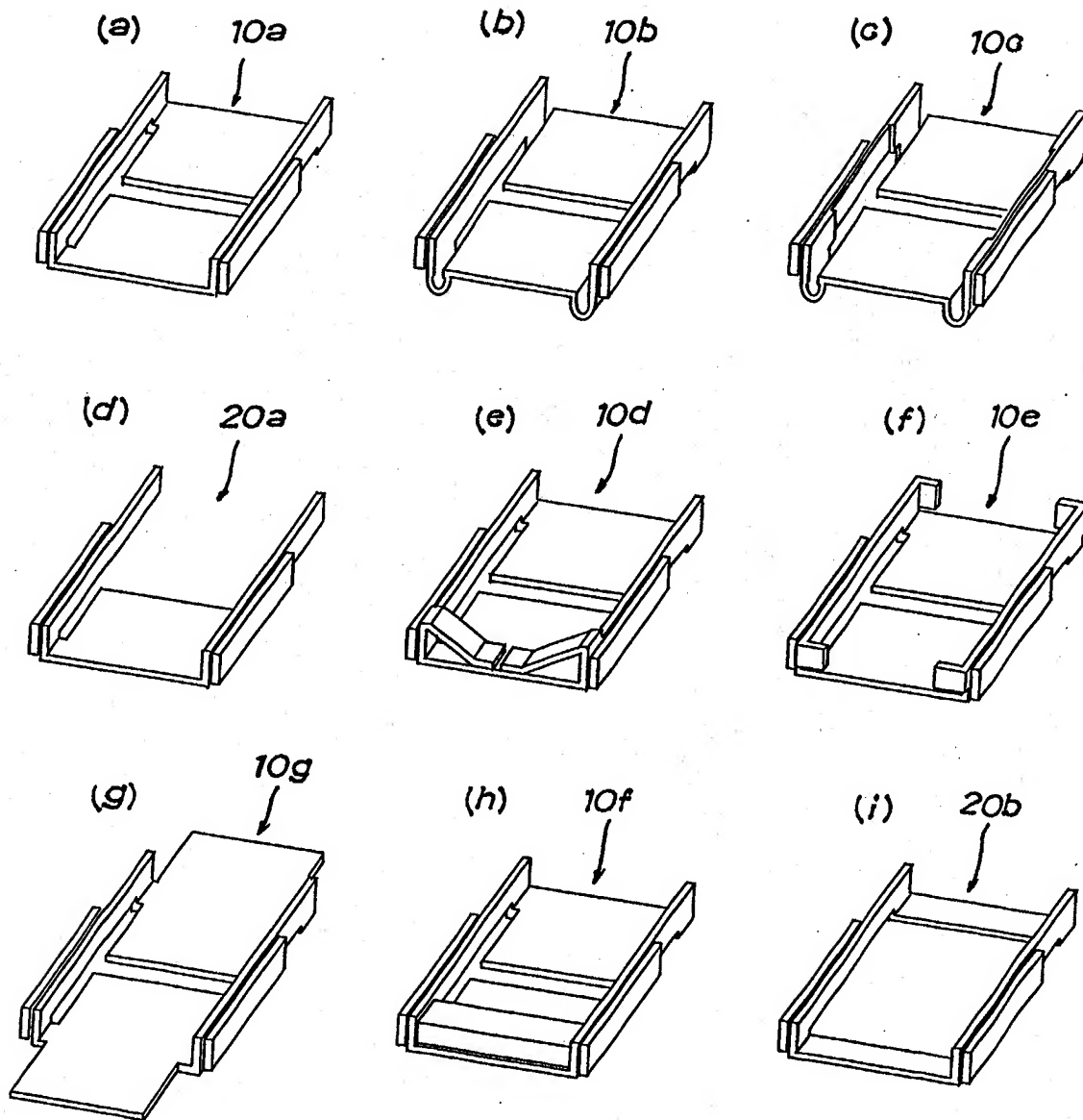
【図 30】第 1 圧電／電歪デバイスの第 2 の変形例を示す斜視図である。

【符号の説明】

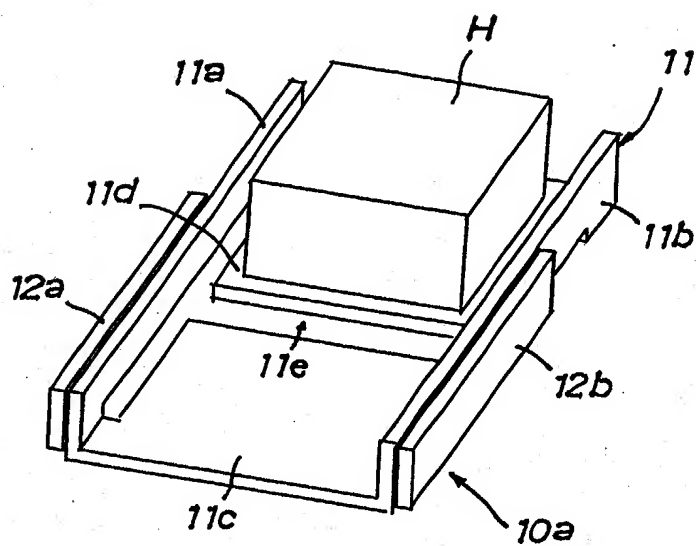
10a~10f、10a1、10a2…圧電／電歪デバイス、11…基体、11A…原板、11a、11b…可動部、11c…固定部、11d…取付部、11c1、11d1…窪み部、11c2、11d2…貫通穴、11e…開口部、11e1、11e2…側方溝部、11e3…中央溝部、12a、12b…圧電／電歪素子、13…基体、13A…原板、13a、13b…可動部、13a1、13b1…円弧状の屈曲部、13c…固定部、13d…取付部、13e…開口部、14…基体、14A…原板、14a、14b…可動部、14a1、14b1…薄肉部、14c…固定部、14d…取付部、14e…開口部、15…基体、15A…原板、15a、15b…可動部、15c…固定部、15d…取付部、15e…開口部、15f、15g…補強部、16…基体、16A…原板、16a、16b…可動部、16c…固定部、16d…取付部、16e…開口部、16f、16g…補強部、17…基体、17A…原板、17a、17b…可動部、17c…固定部、17d…取付部、17e…開口部、17f…補強部材、18…基体、18A…原板、18a、18b…可動部、18c…固定部、18d…取付部、18e…開口部、20a、20b、20c、20d…圧電／電歪デバイス、21…基体、21A…原板、21a、21b…可動部、21a1、21b1…先端側内面、21a2、21b2…折曲部、21a3、21b3…屈折部、21c…固定部、21d…開口部、21d1、21d2…側方溝部、21d3…開口部位、22a、22b…圧電／電歪素子、23…基体、23A…原板、23a、23b…可動部、23c…固定部、23d…取付部、23e…開口部、31、32、33、34…圧電／電歪素子、31a、32a、32b、33a~33d、34a~34d…圧電／電歪層、31b、31c、32c、32d、33e、33f、34e、34f…電極、31d、31d、32e、32f、33g、33h、34g、34h…端子。

【書類名】 図面

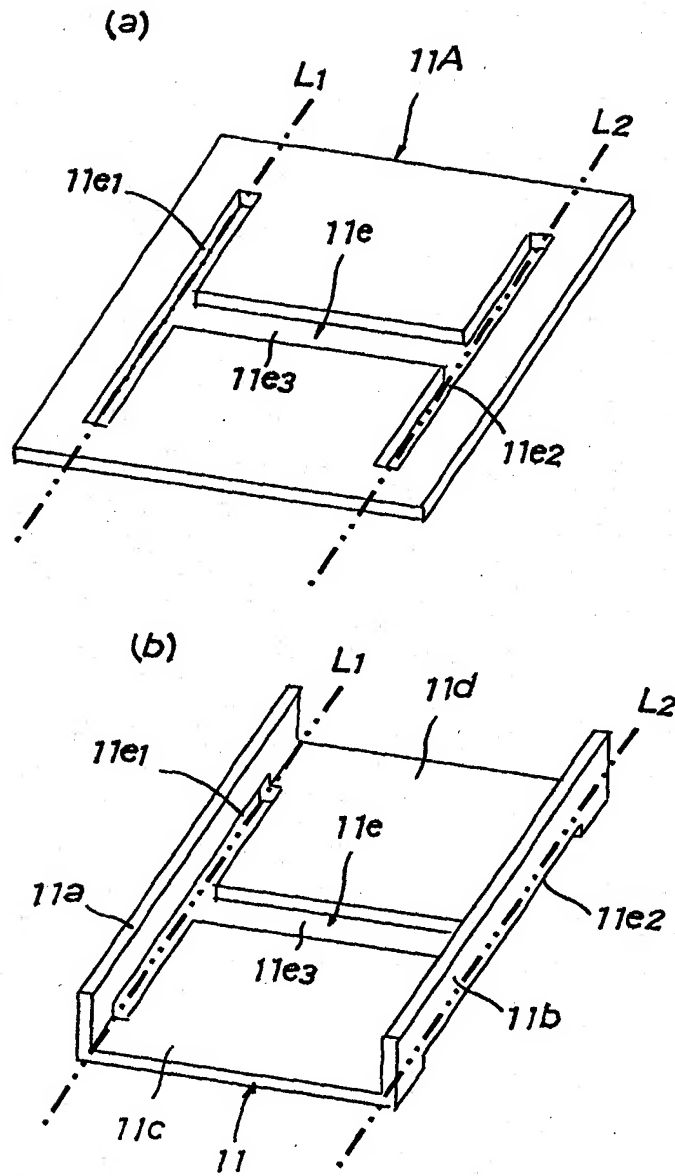
【図1】



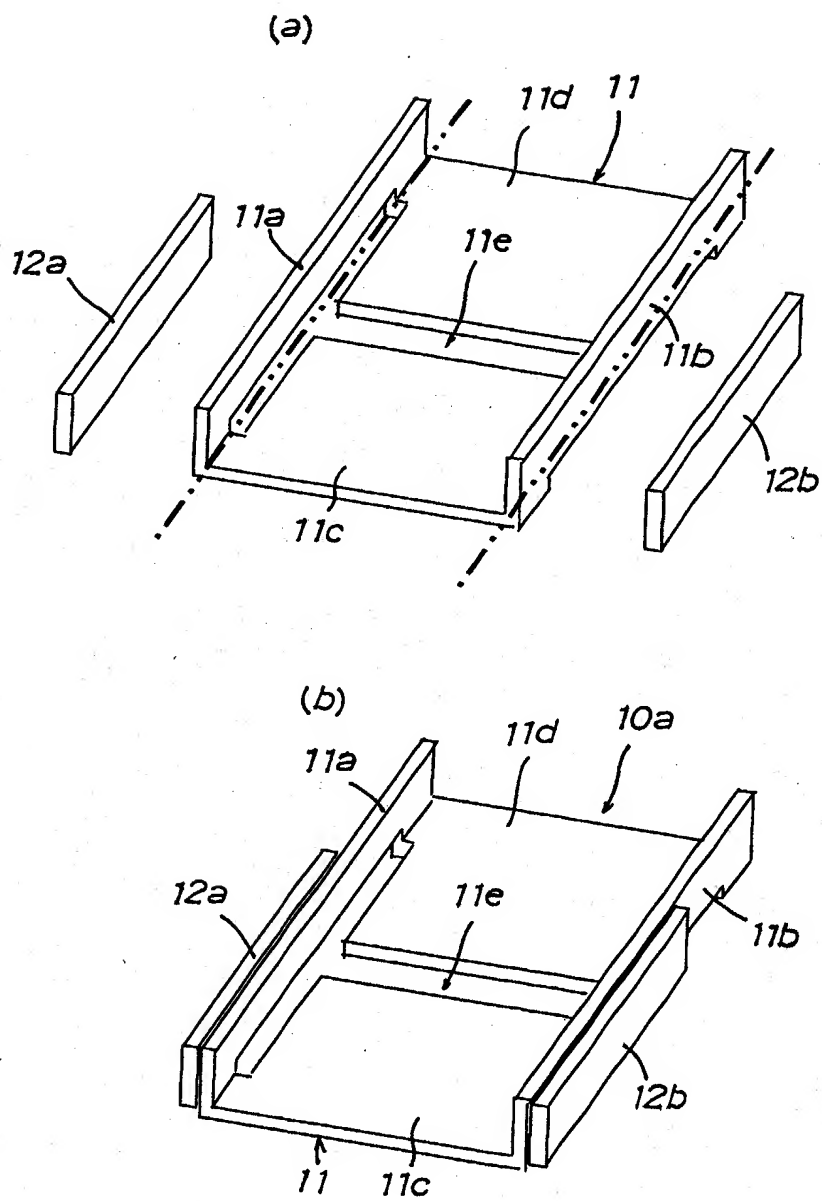
【図2】



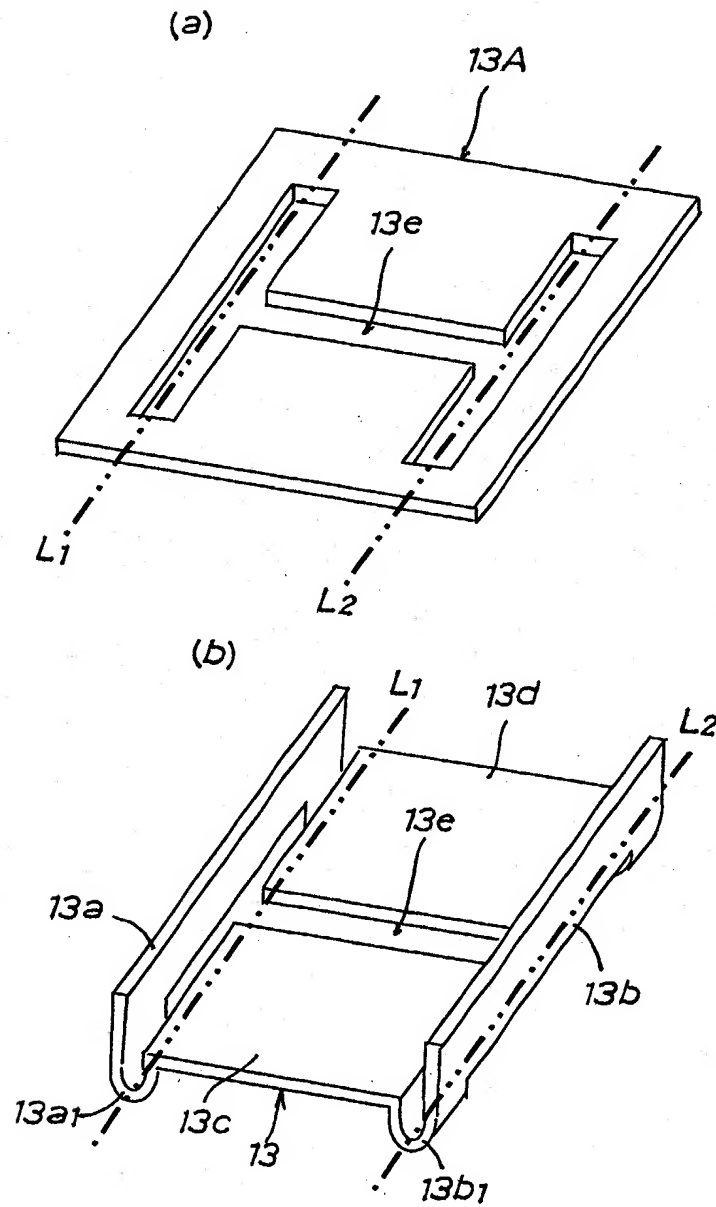
【図 3】



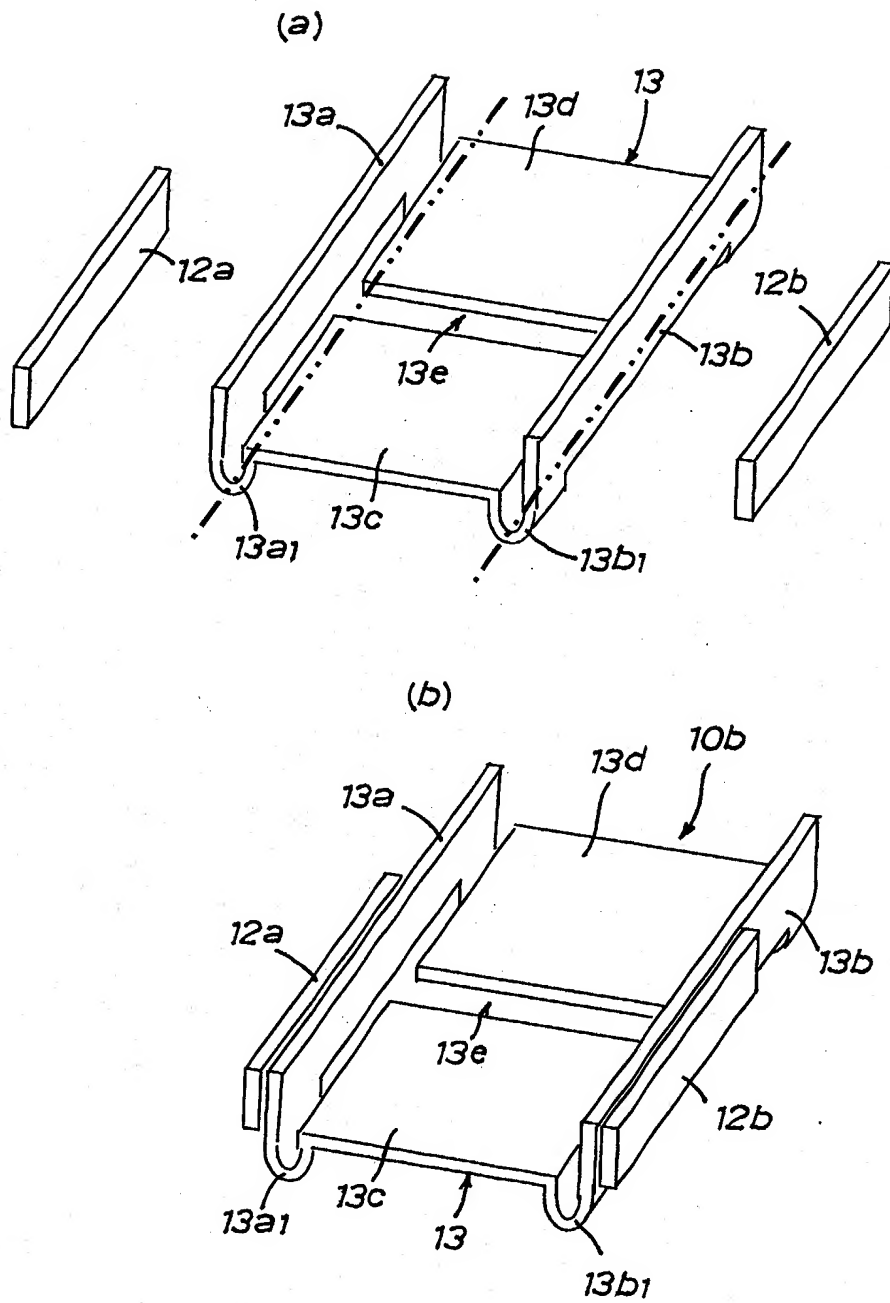
【図4】



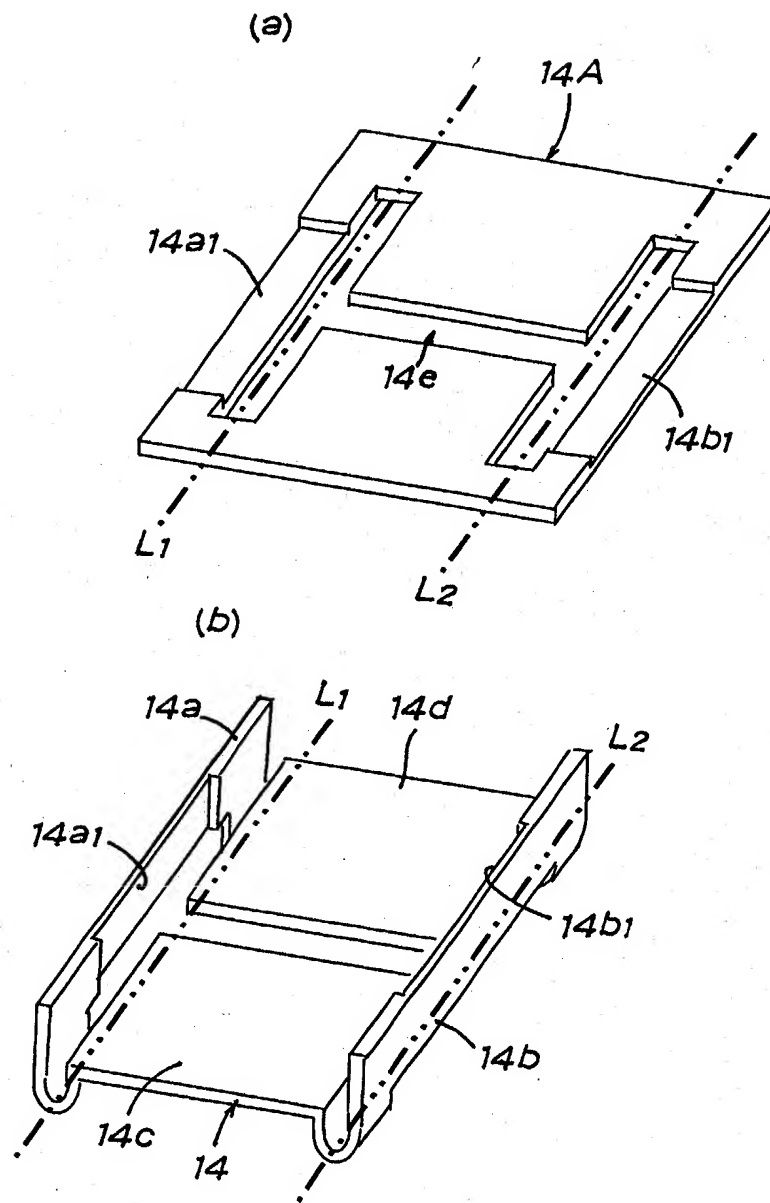
【図5】



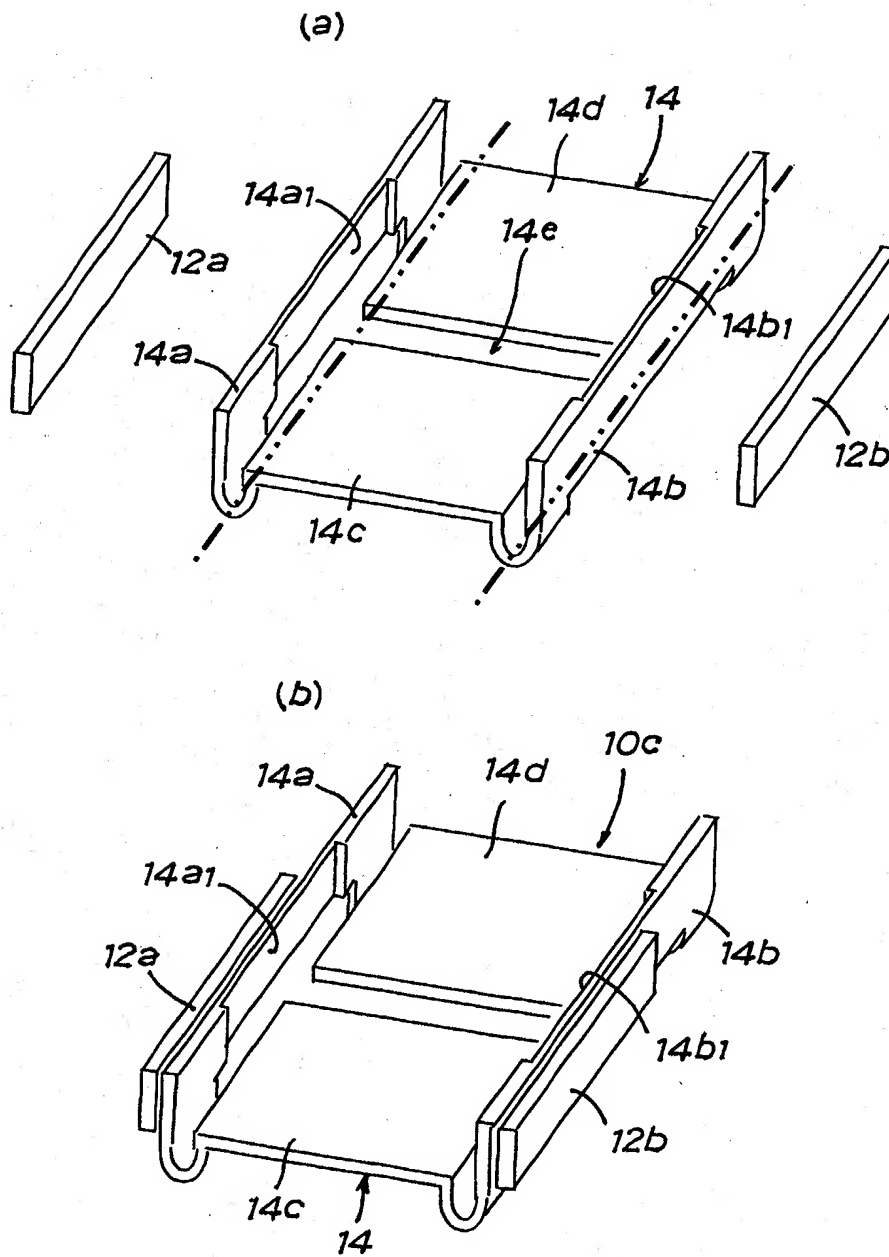
【図 6】



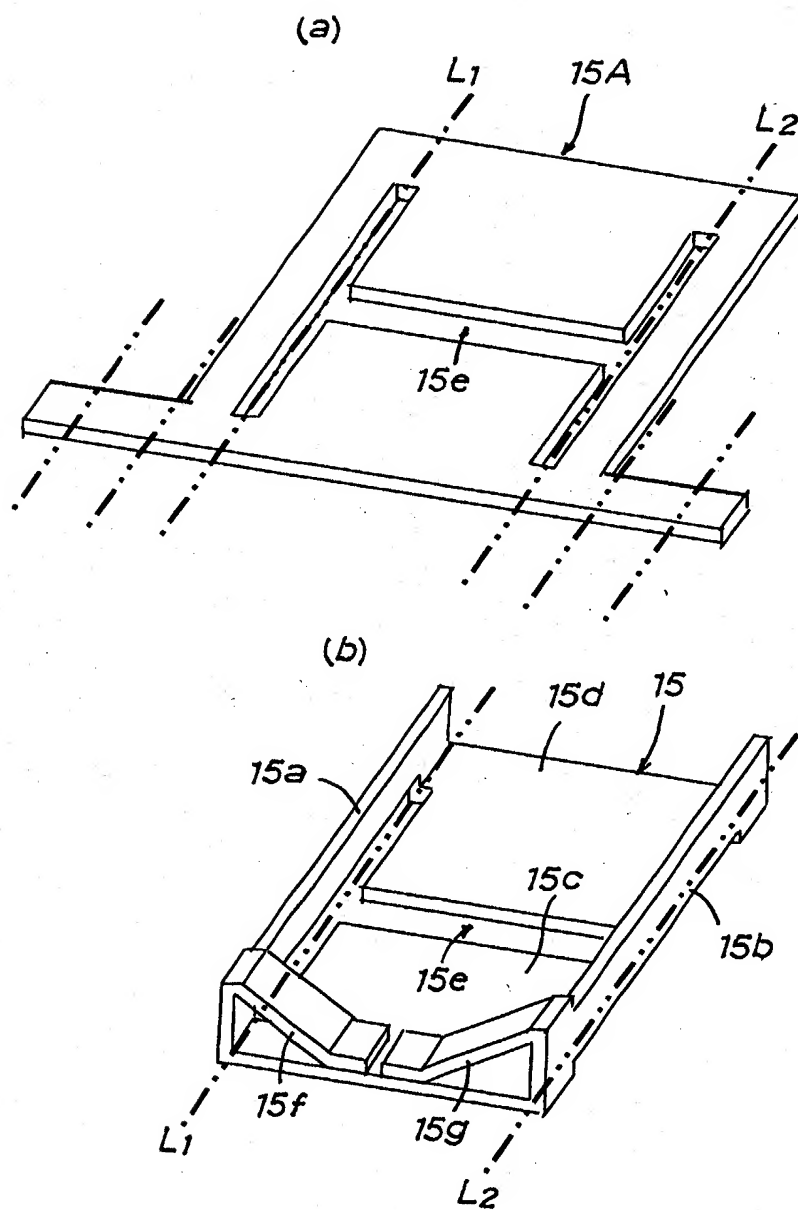
【図 7】



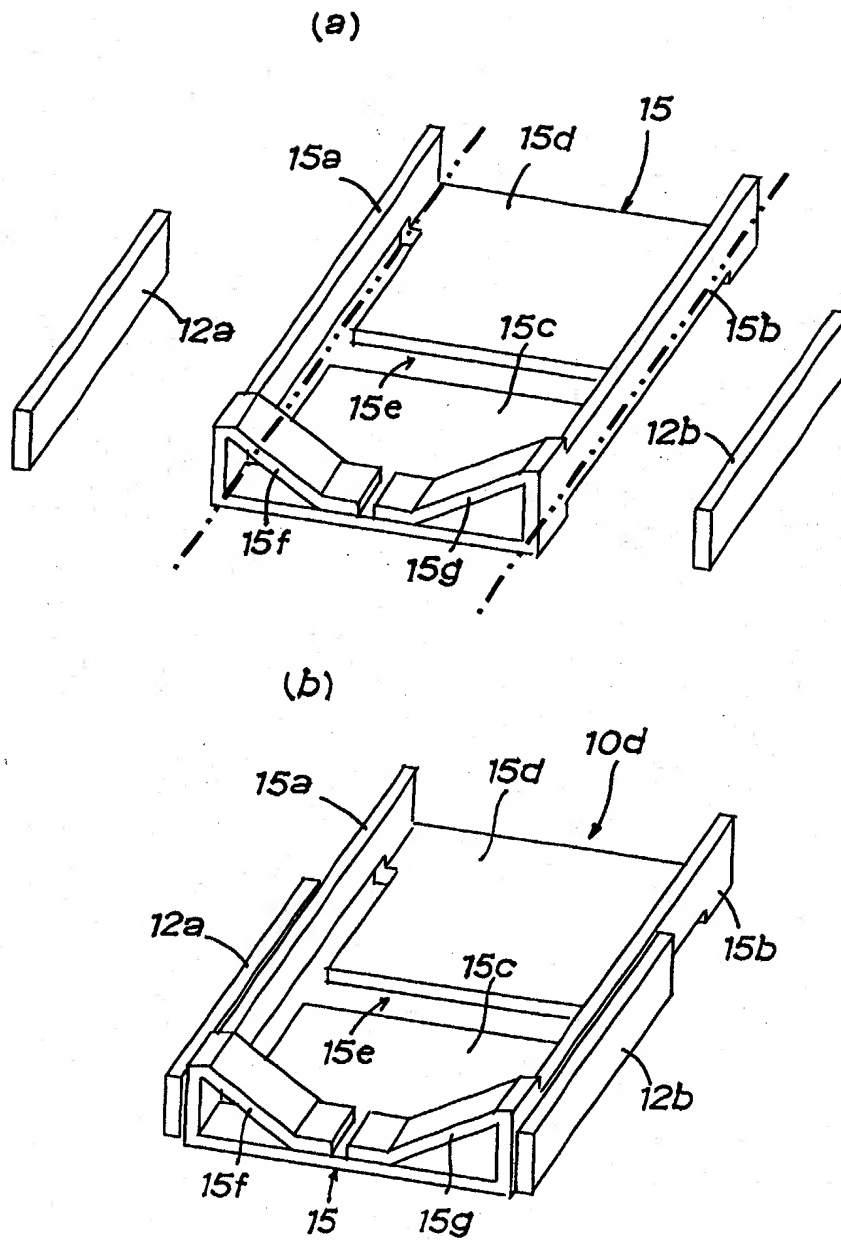
【図8】



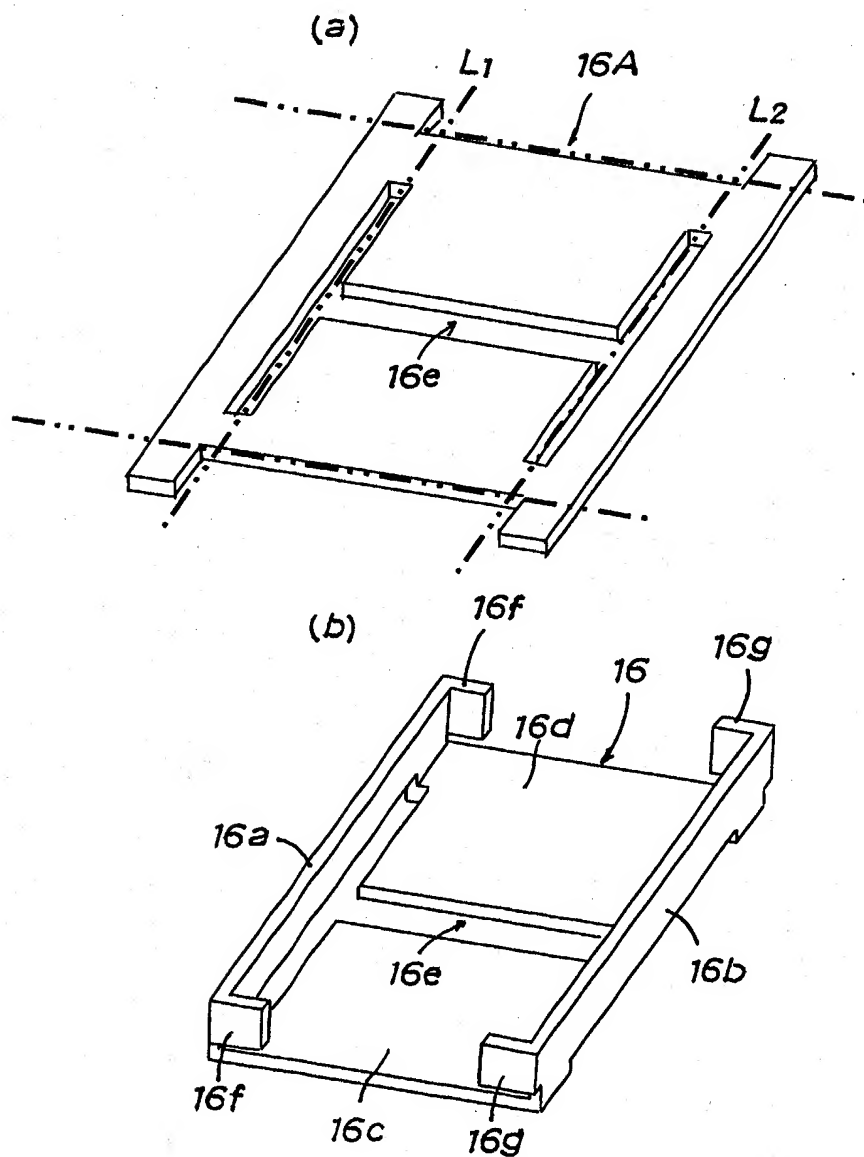
【図9】



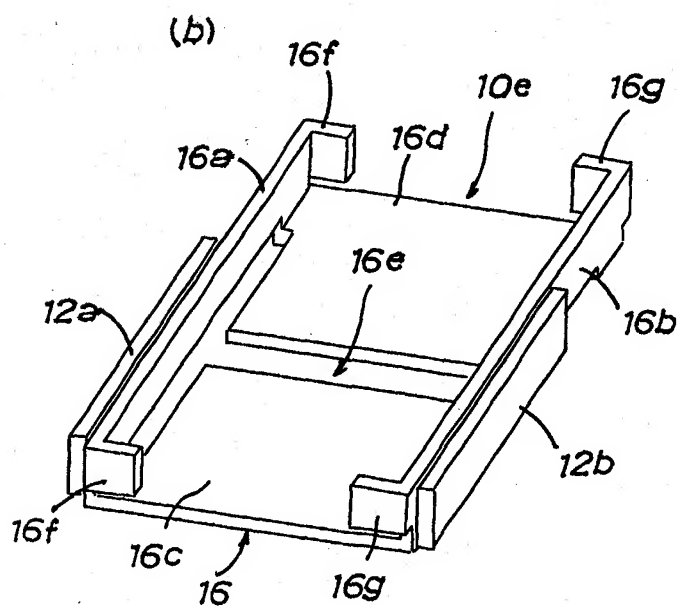
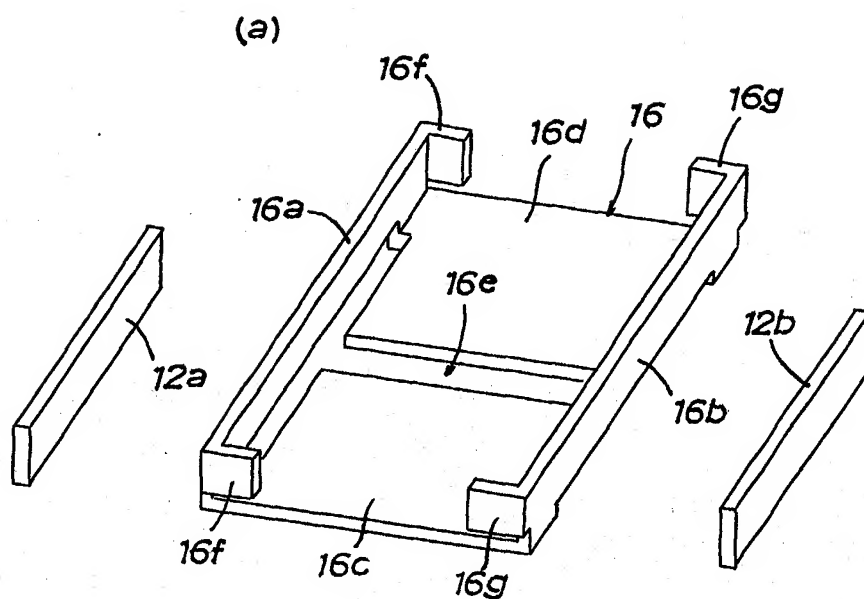
【図10】



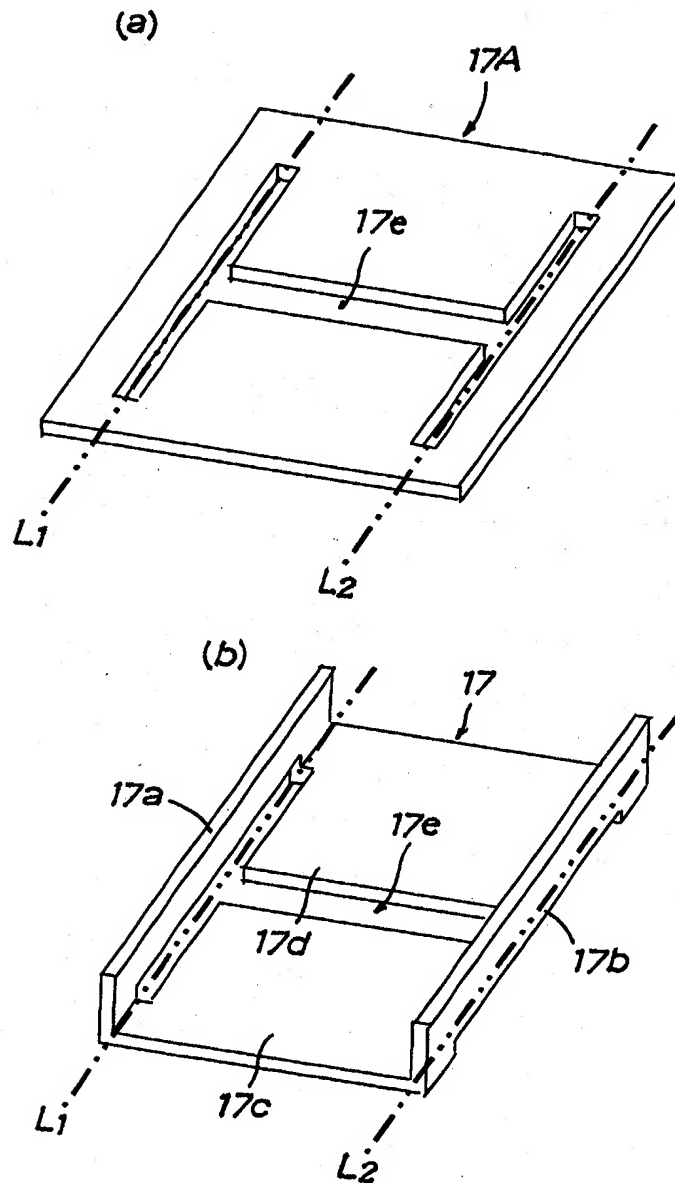
【図11】



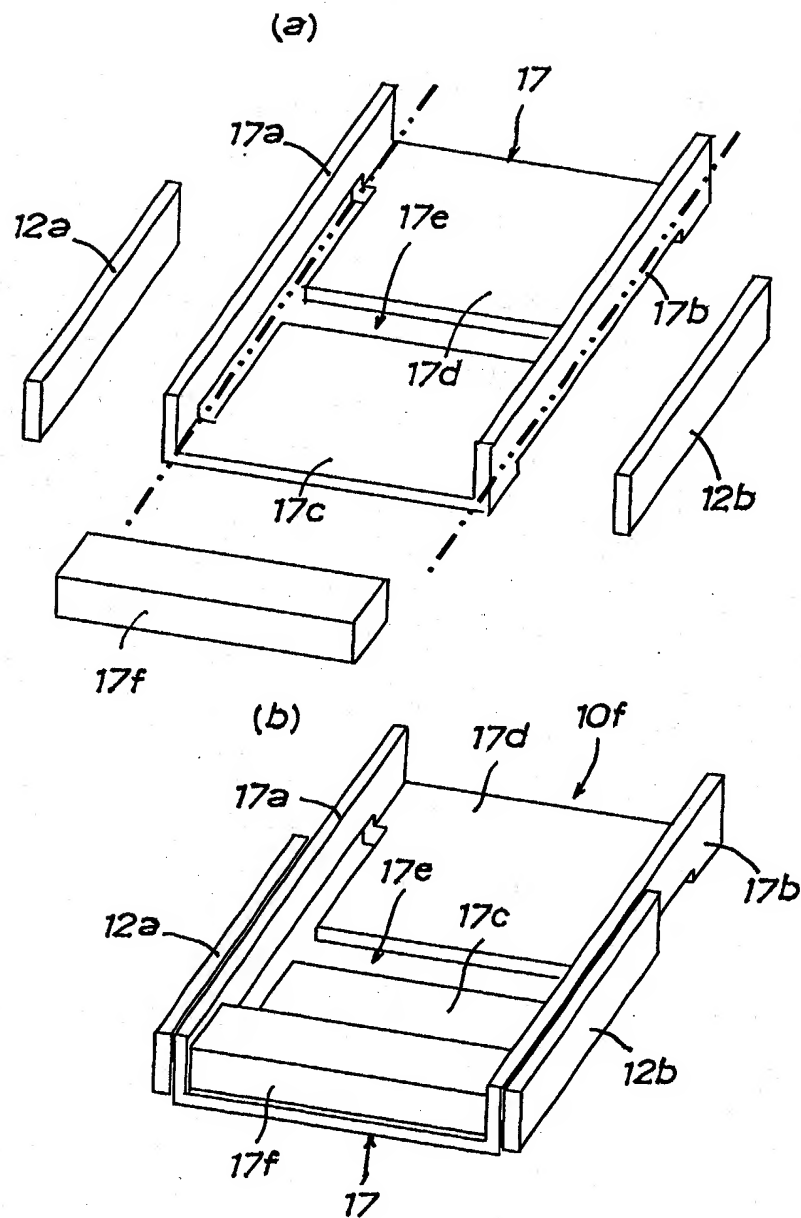
【図12】



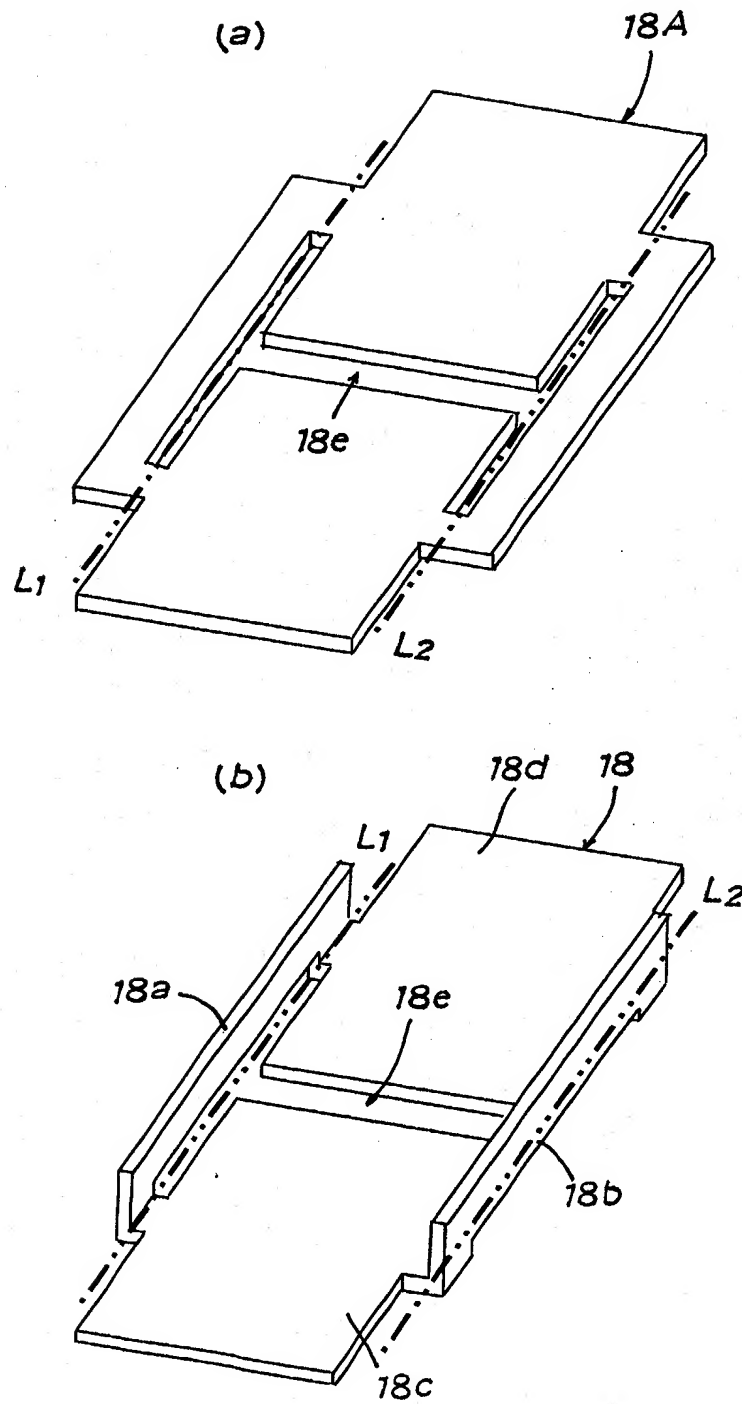
【図13】



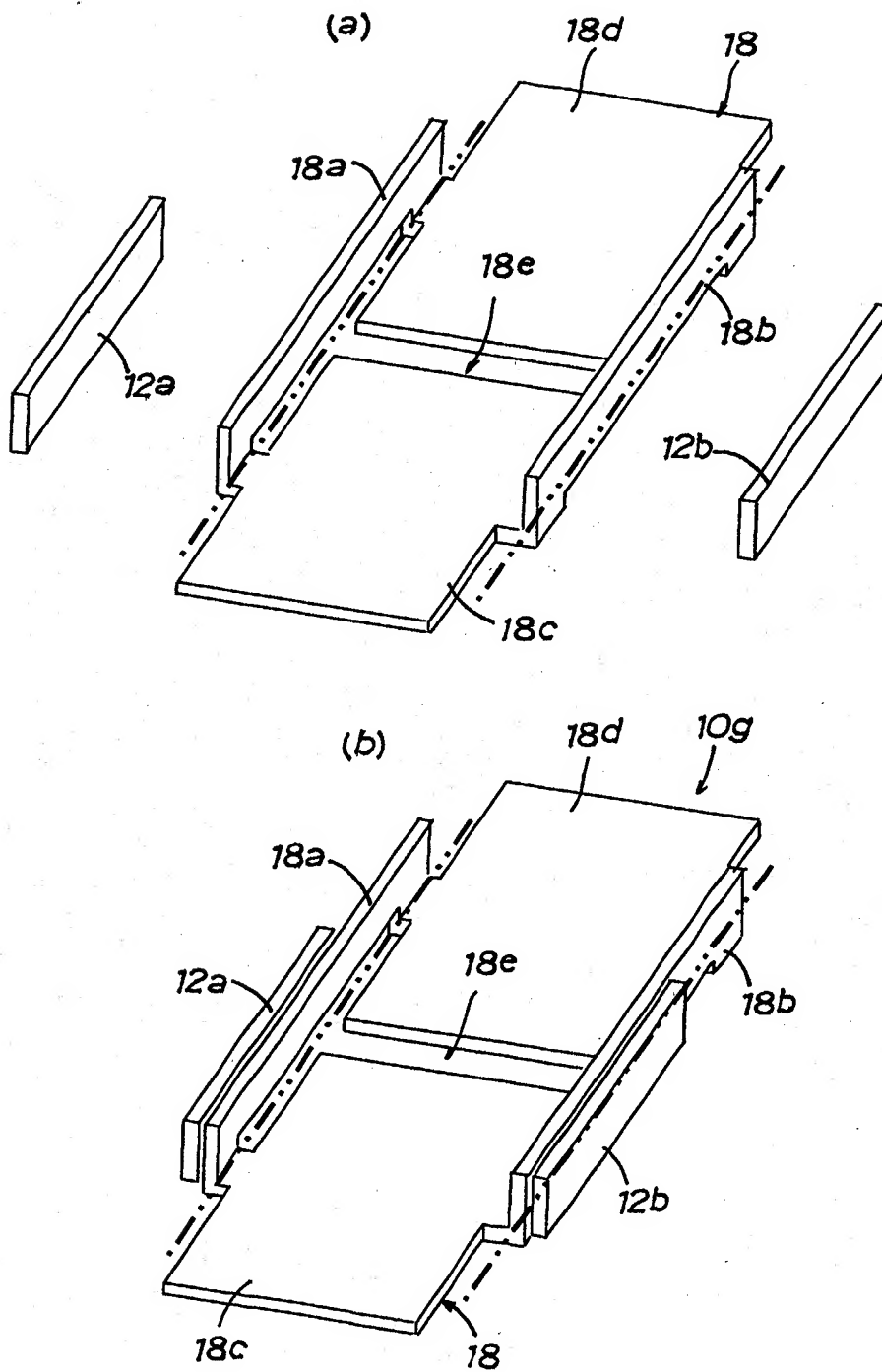
【図 1 4】



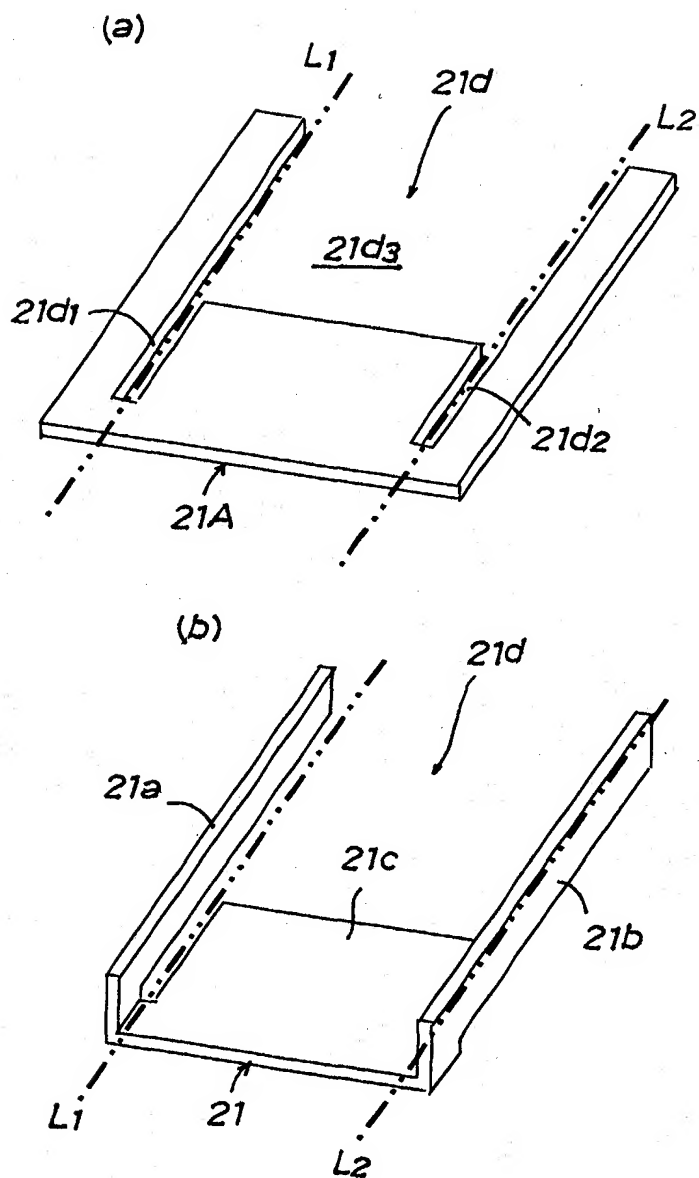
【図15】



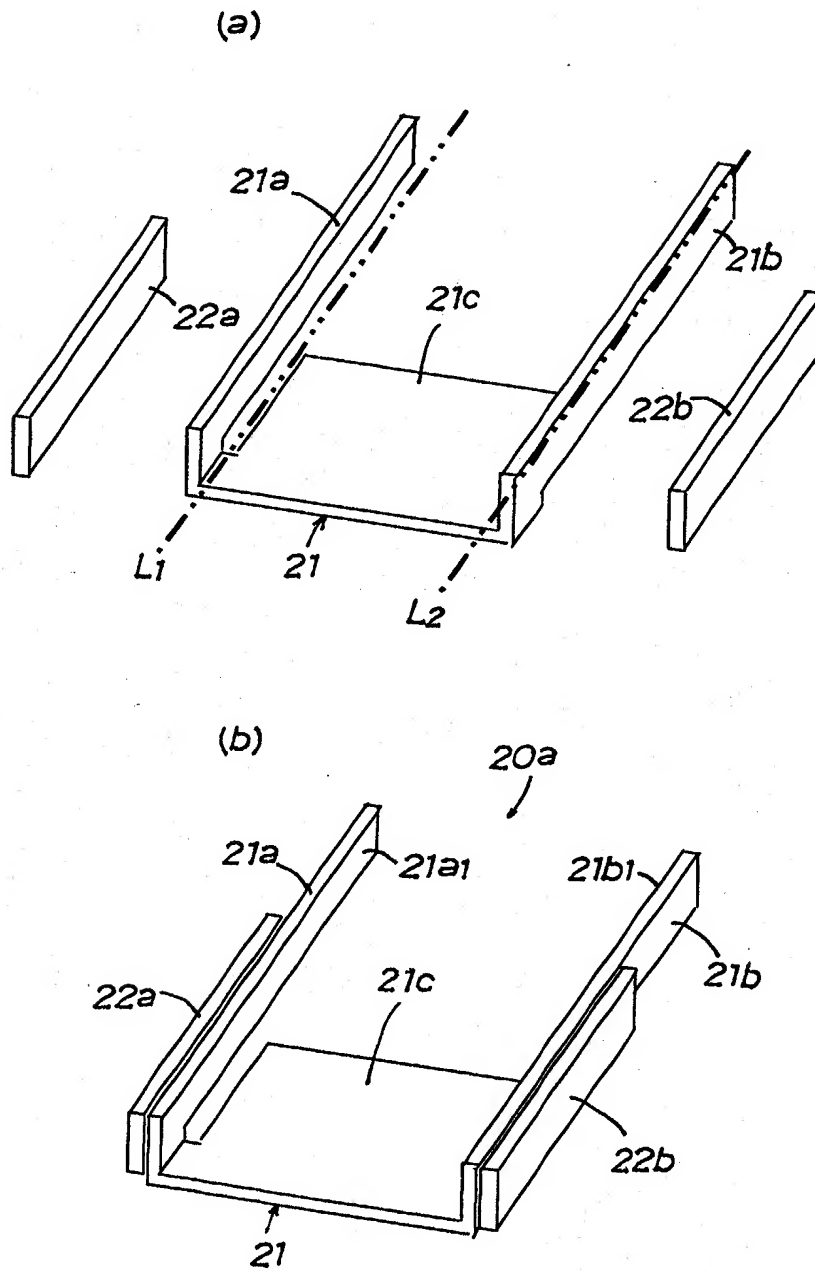
【図16】



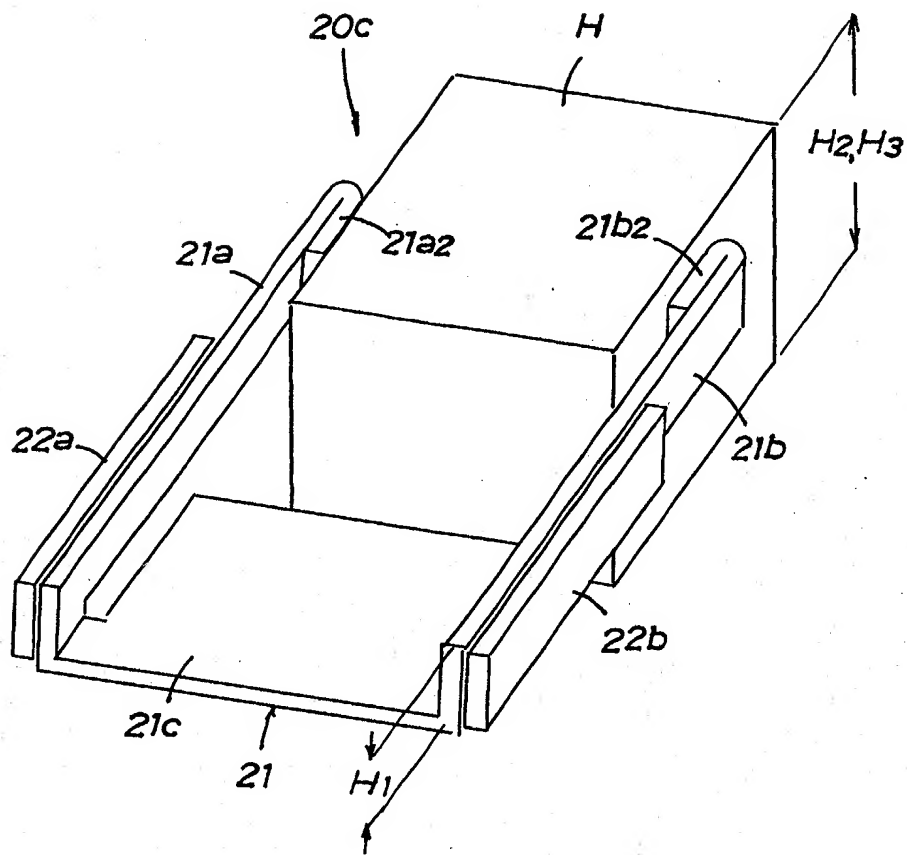
【図17】



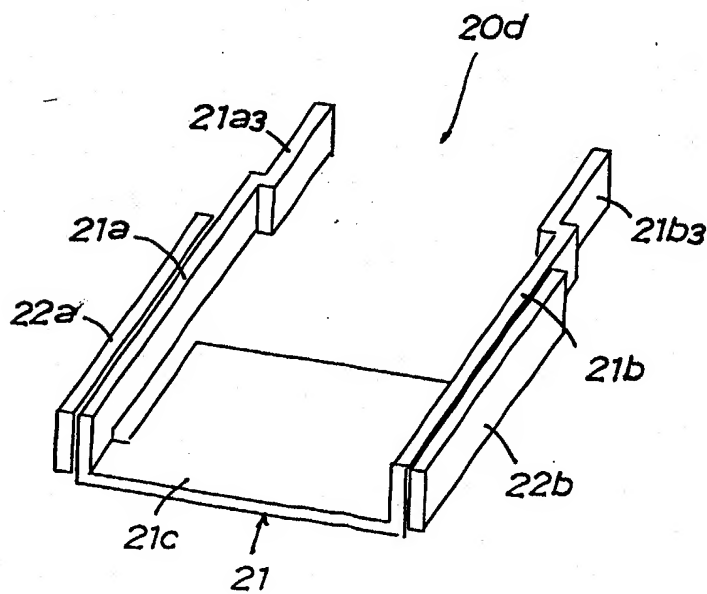
【図 1 8】



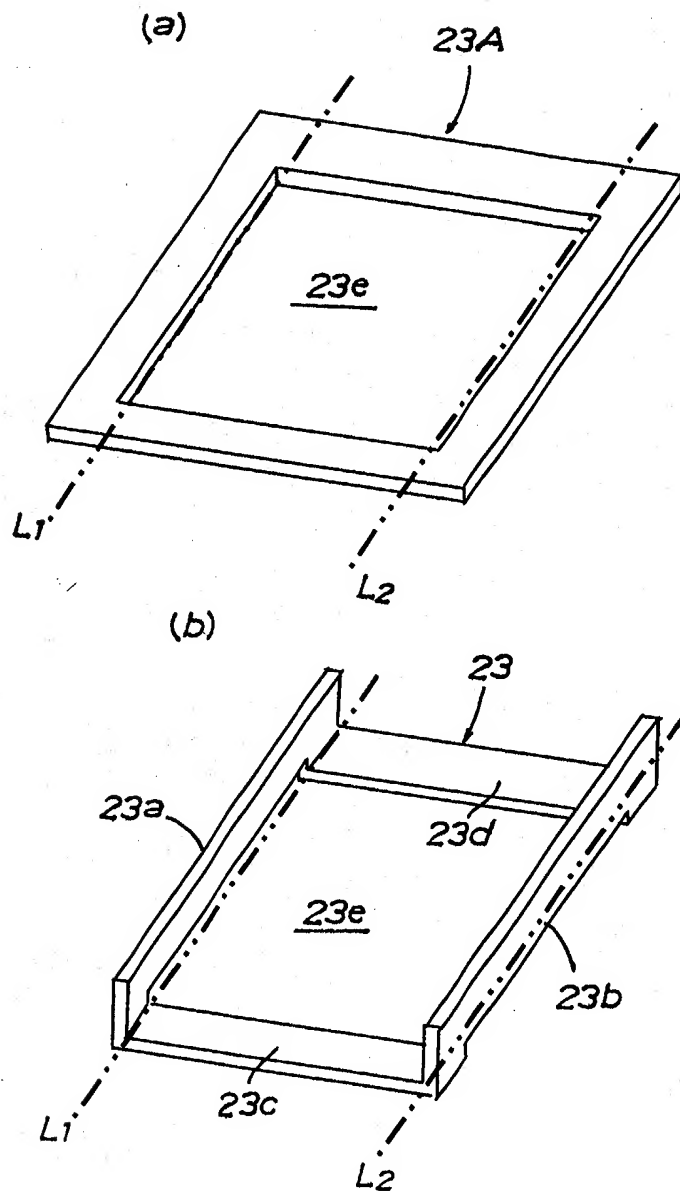
【図 1 9】



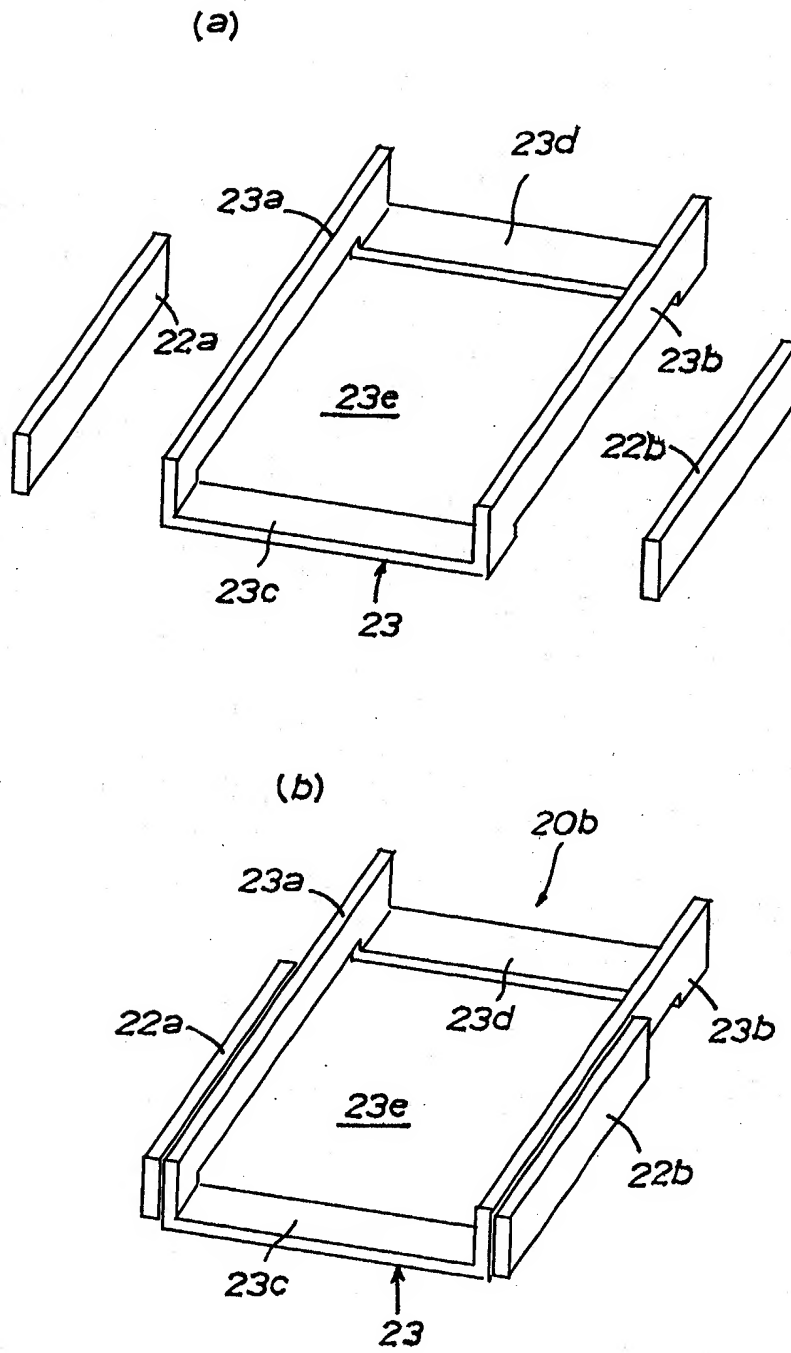
【図 2 0】



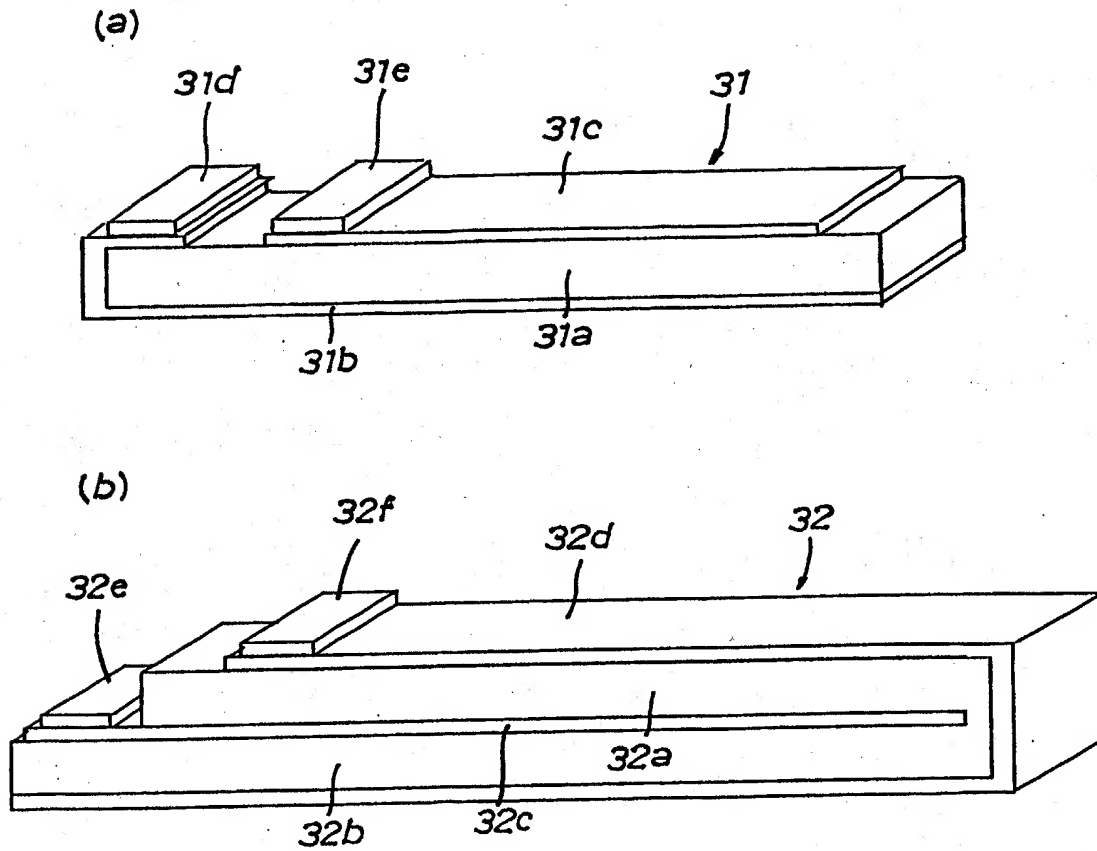
【図 2 1】



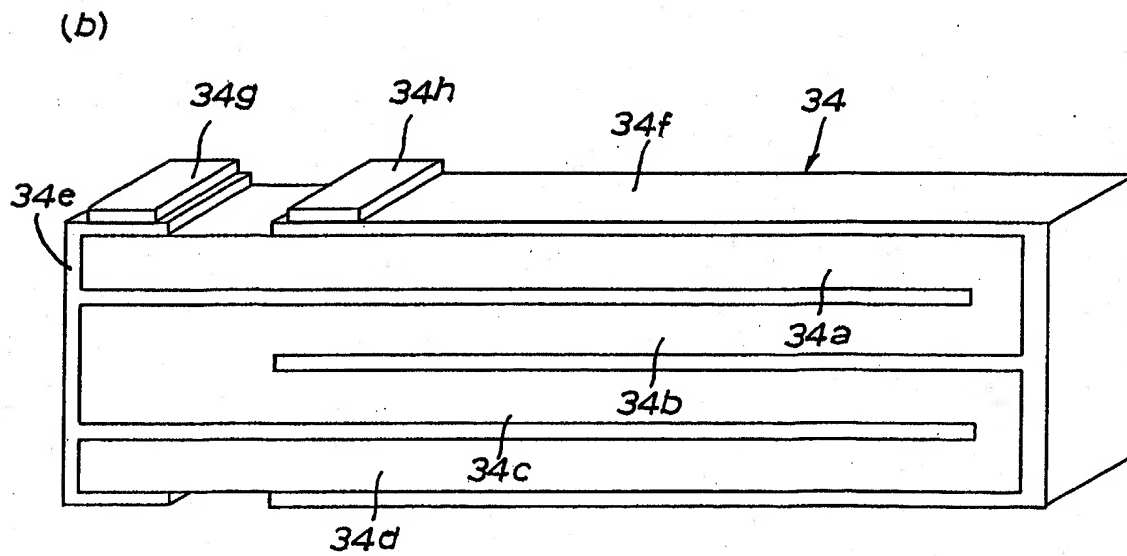
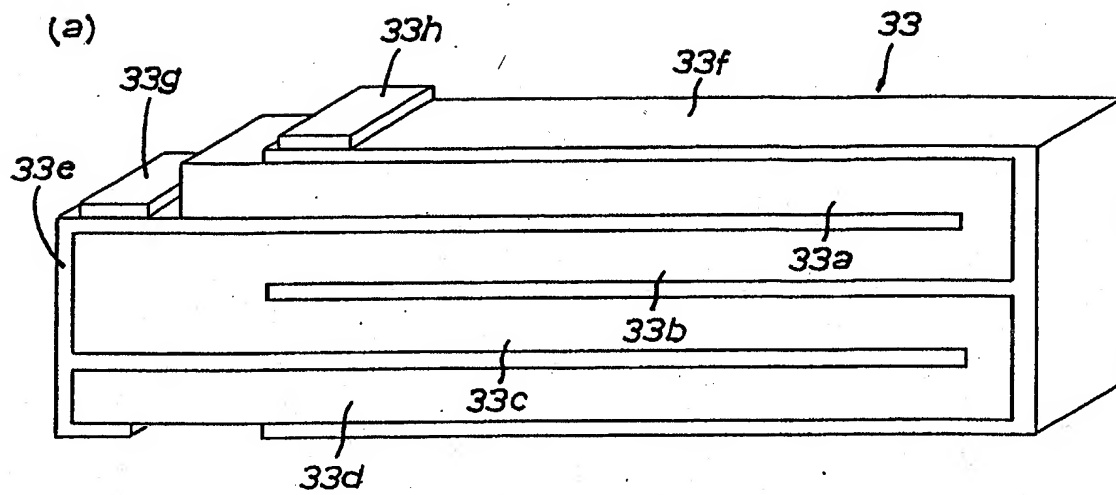
【図 2 2】



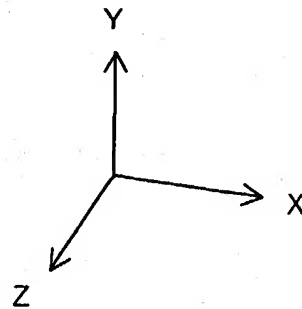
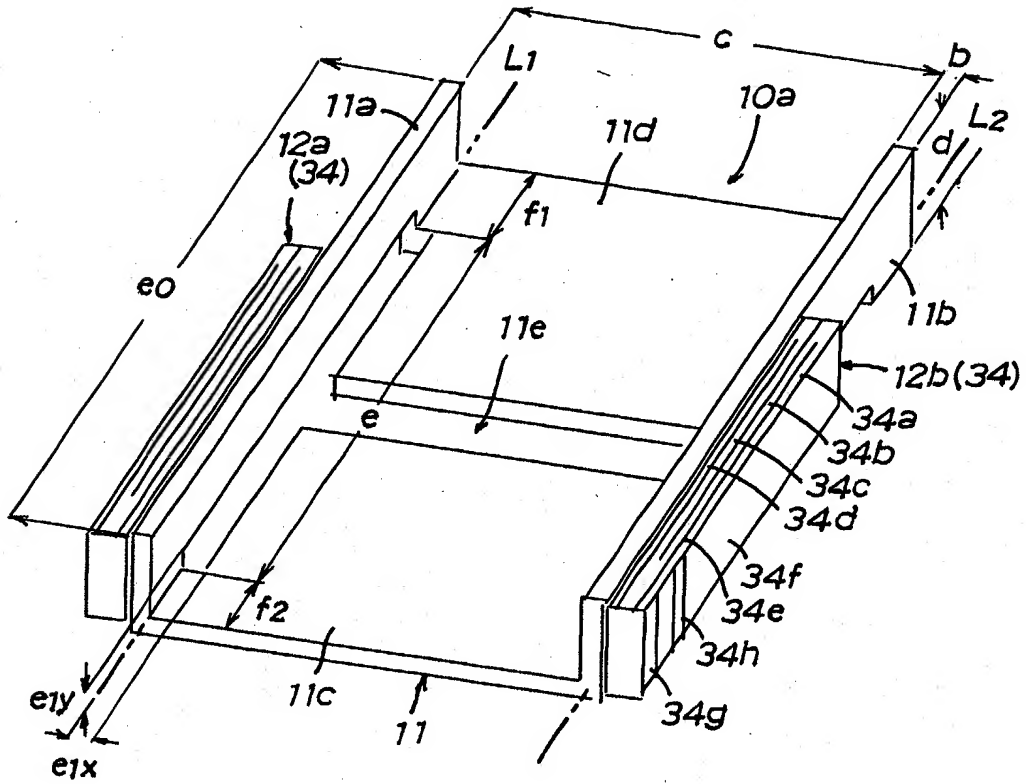
【図 23】



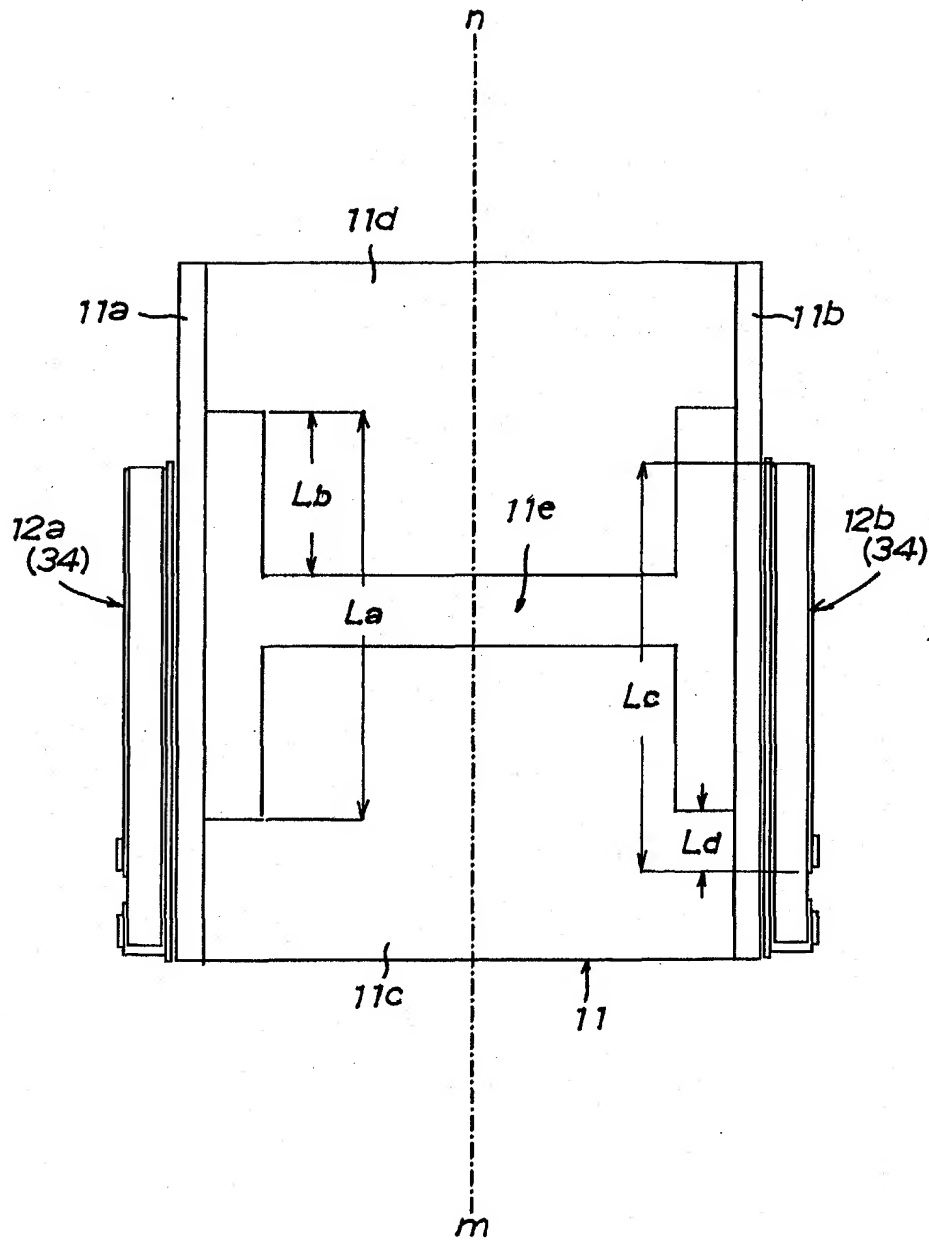
【図 24】



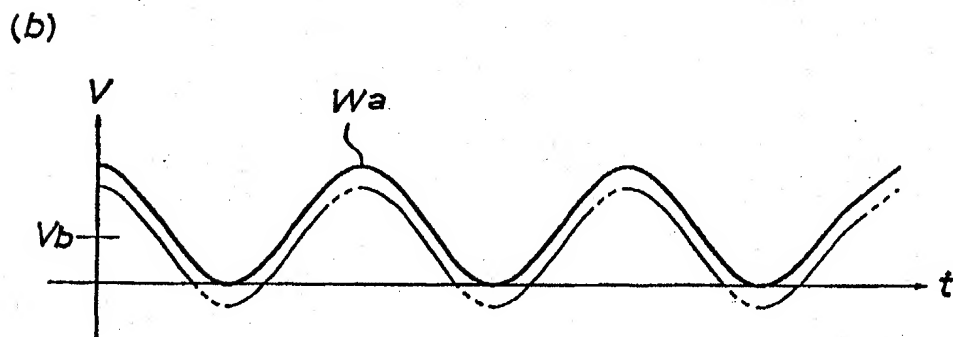
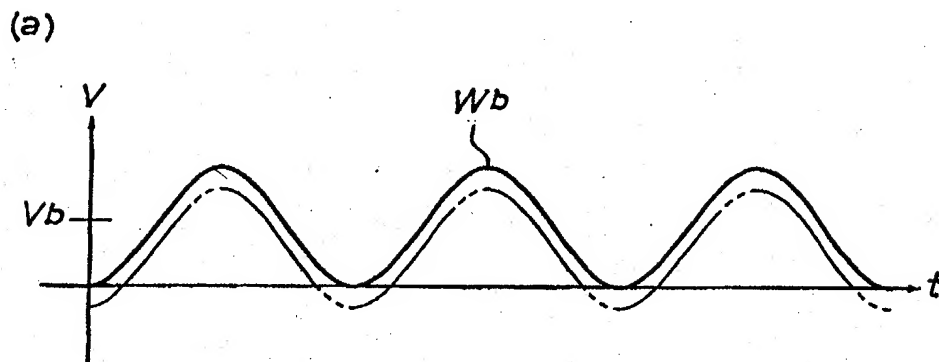
【図25】



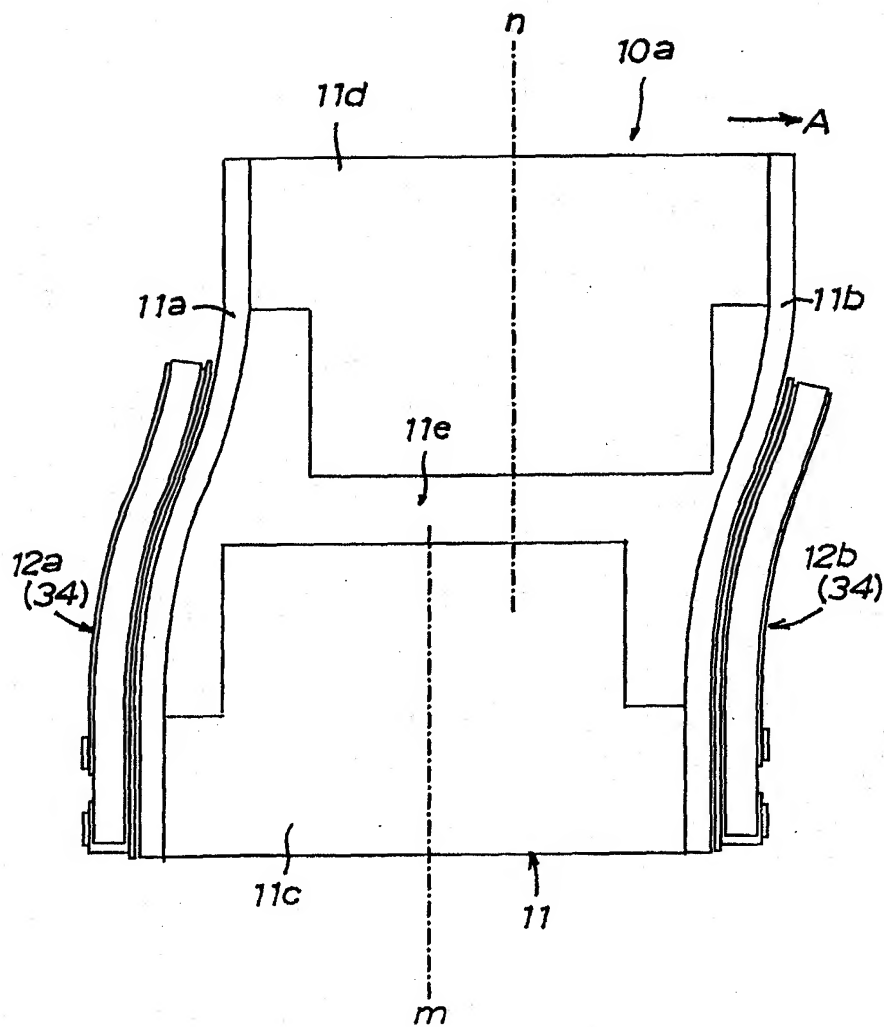
【図 26】



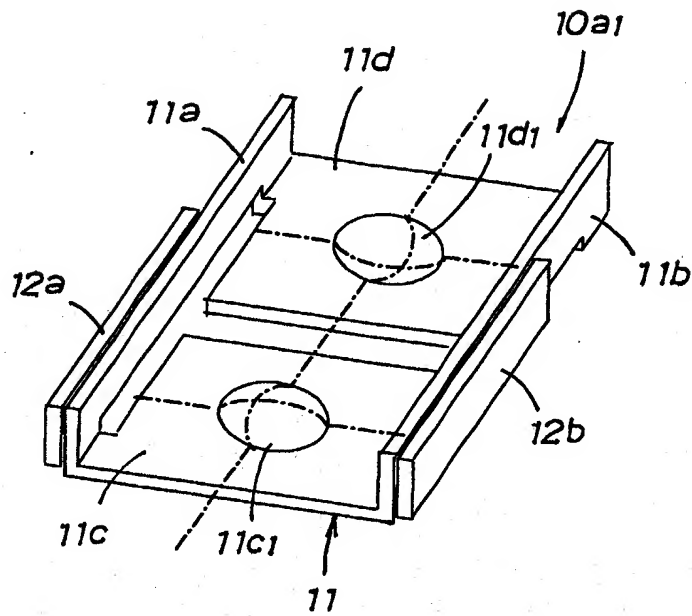
【図 27】



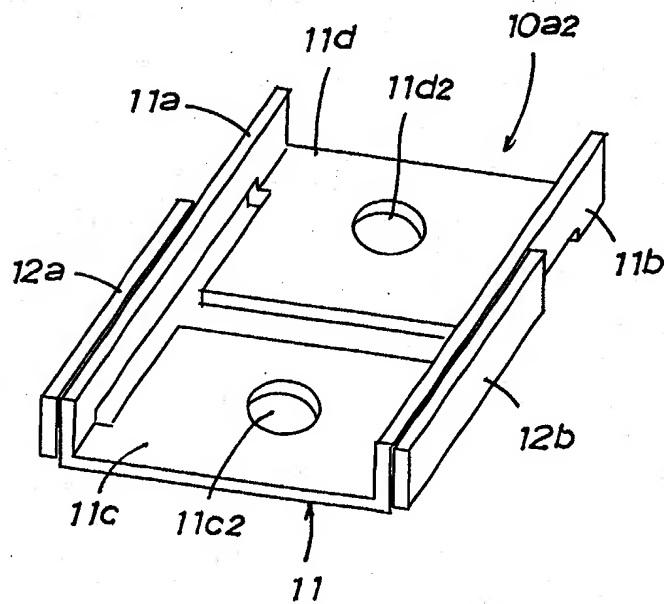
【図28】



【図 2 9】



【図 3 0】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 左右一対の可動部11a, 11bとその一端部側に固定部11cを有する基体11と、基体11の可動部11a, 11bの側面に配設した圧電／電歪素子12a, 12bを具備する圧電／電歪デバイスを、部品点数の少ない構成とする。

【解決手段】 圧電／電歪デバイスの基体として、基体を平板状に展開した形状に打抜き加工してなる原板を屈曲加工した一体構造の基体11を採用することにより、部品点数の少ない構成の圧電／電歪デバイスを提供する。

【選択図】 図2

特 2001-010622

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-010622
受付番号	50100066309
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0094
作成日	平成13年 1月19日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 1月18日

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100088971

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区椿町15番19号 大正生命ビル プロスペック特許事務所

【氏名又は名称】 大庭 咲夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100115185

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区椿町15番19号 大正生命ビル プロスペック特許事務所

【氏名又は名称】 加藤 慎治

【選任した代理人】

【識別番号】 100076842

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中区錦1丁目6番17号 オリジン錦 長谷国際特許事務所

【氏名又は名称】 高木 幹夫

次頁無

特2001-010622

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名

日本碍子株式会社